



Electronics for the Future

決算説明会 2023年度 通期業績

2024年5月9日
ローム株式会社
代表取締役社長 松本 功

- | 2023年度通期 業績報告
- | 2024年度通期 発表計画
- | 設備投資の状況
- | 在庫の状況
- | LSI事業の戦略
- | パワーデバイス事業の戦略
- | 産機ロングテール戦略
- | 株主還元
- | 中期経営計画の進捗報告
- | 東芝との協業によるシナジーについて

2023年度 通期 実績 (再修正計画比、前年比)

(単位：億円)

	FY2023 実績	FY2023 再修正計画	計画比	FY2022 実績	前年比
売上高	4,677	4,700	▲0.5%	5,078	▲7.9%
営業利益	433	440	▲1.5%	923	▲53.1%
(対売上比率)	(9.3%)	(9.4%)	-	(18.2%)	-
経常利益	692	640	+8.1%	1,095	▲36.8%
(対売上比率)	(14.8%)	(13.6%)	-	(21.6%)	-
純利益	539	480	+12.4%	803	▲32.9%
(対売上比率)	(11.5%)	(10.2%)	-	(15.8%)	-
EBITDA	1,153	1,174	▲1.7%	1,484	▲22.3%
(対売上比率)	(24.7%)	(25.0%)	-	(29.2%)	-

期中平均レート(¥/US\$)

(144.40円)

(142.12円)

(134.95円)

期末レート(¥/US\$)

(151.41円)

(140.00円)

(133.53円)

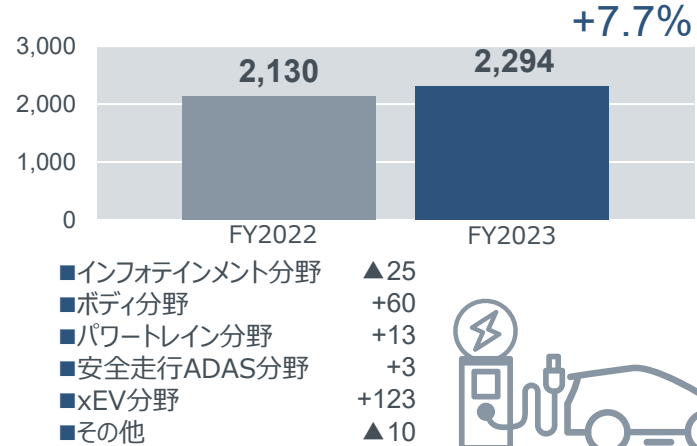
2023年度 通期 市場別 売上の変動要因 (前年比)

(単位：億円)

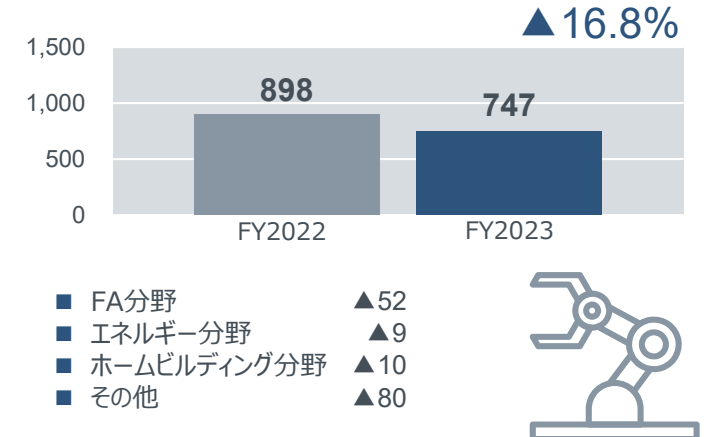
通期売上高



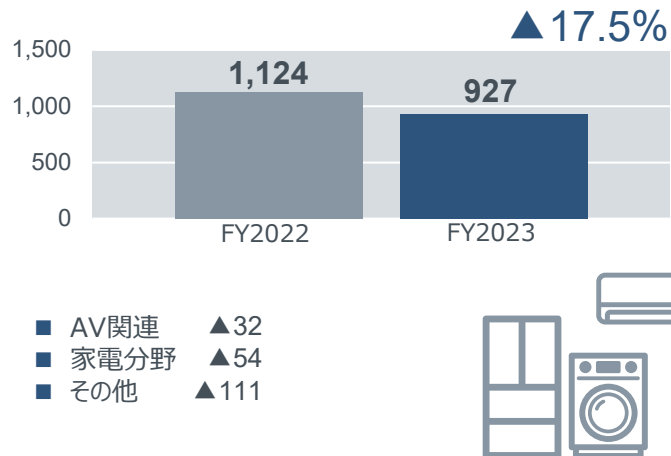
自動車



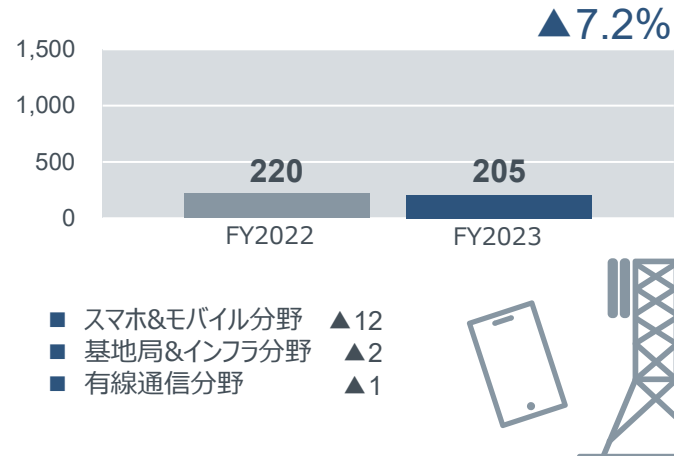
産機



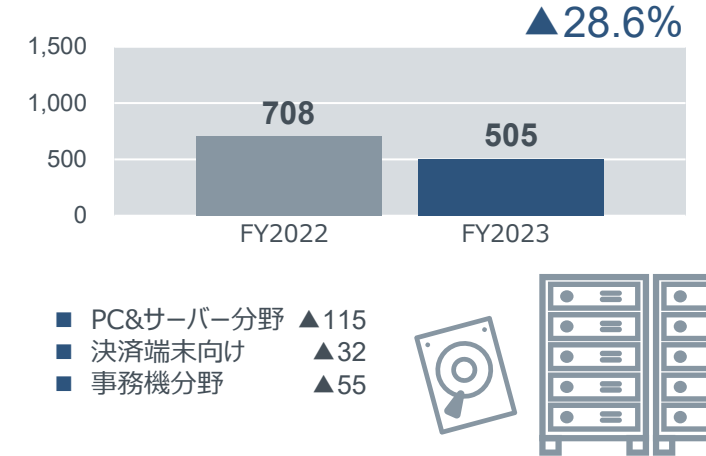
民生



通信



コンピュータ & ストレージ



2023年度 通期 国籍別 売上の変動要因 (前年比)

通期売上高

5,078億円

4,677億円

FY2022 通期実績

FY2023 通期実績

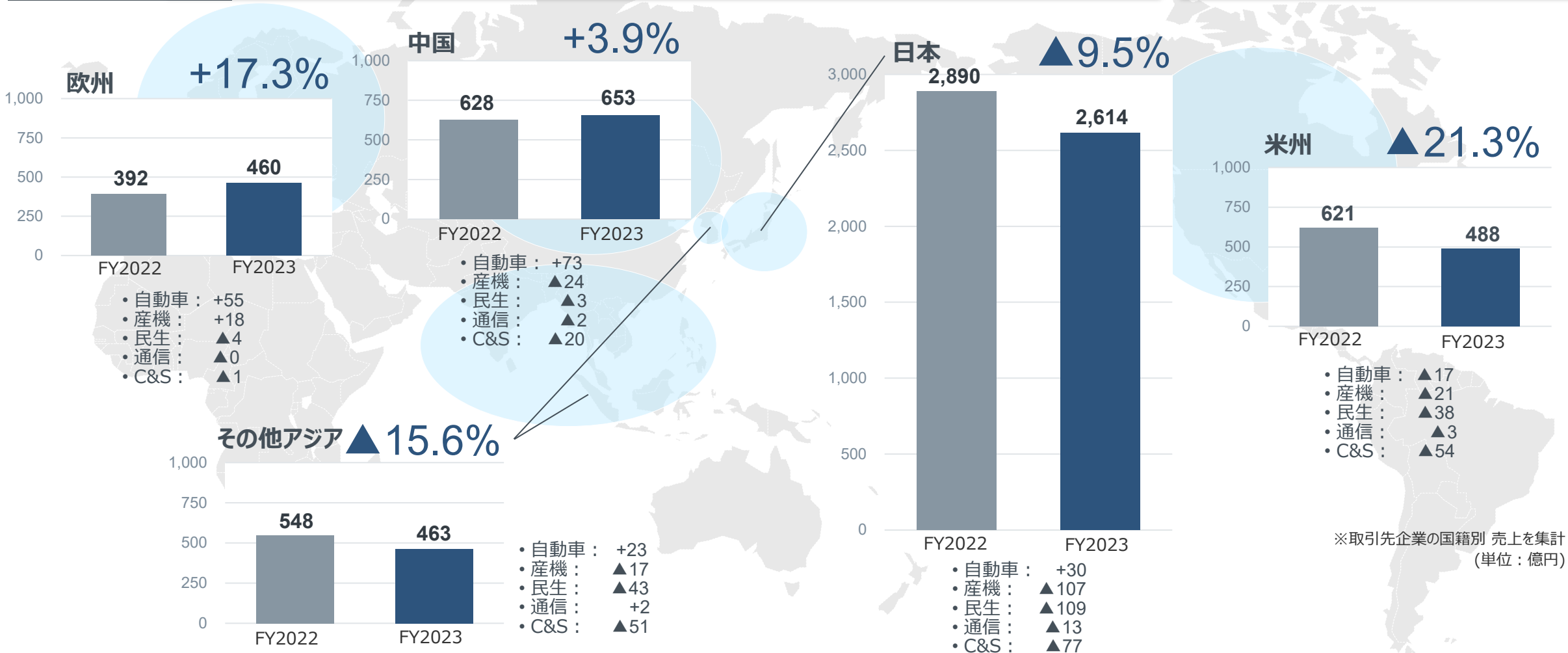
▲7.9%

海外売上高比率

43.1%
FY2022 通期

44.1%
FY2023 通期

通期実績 前年比

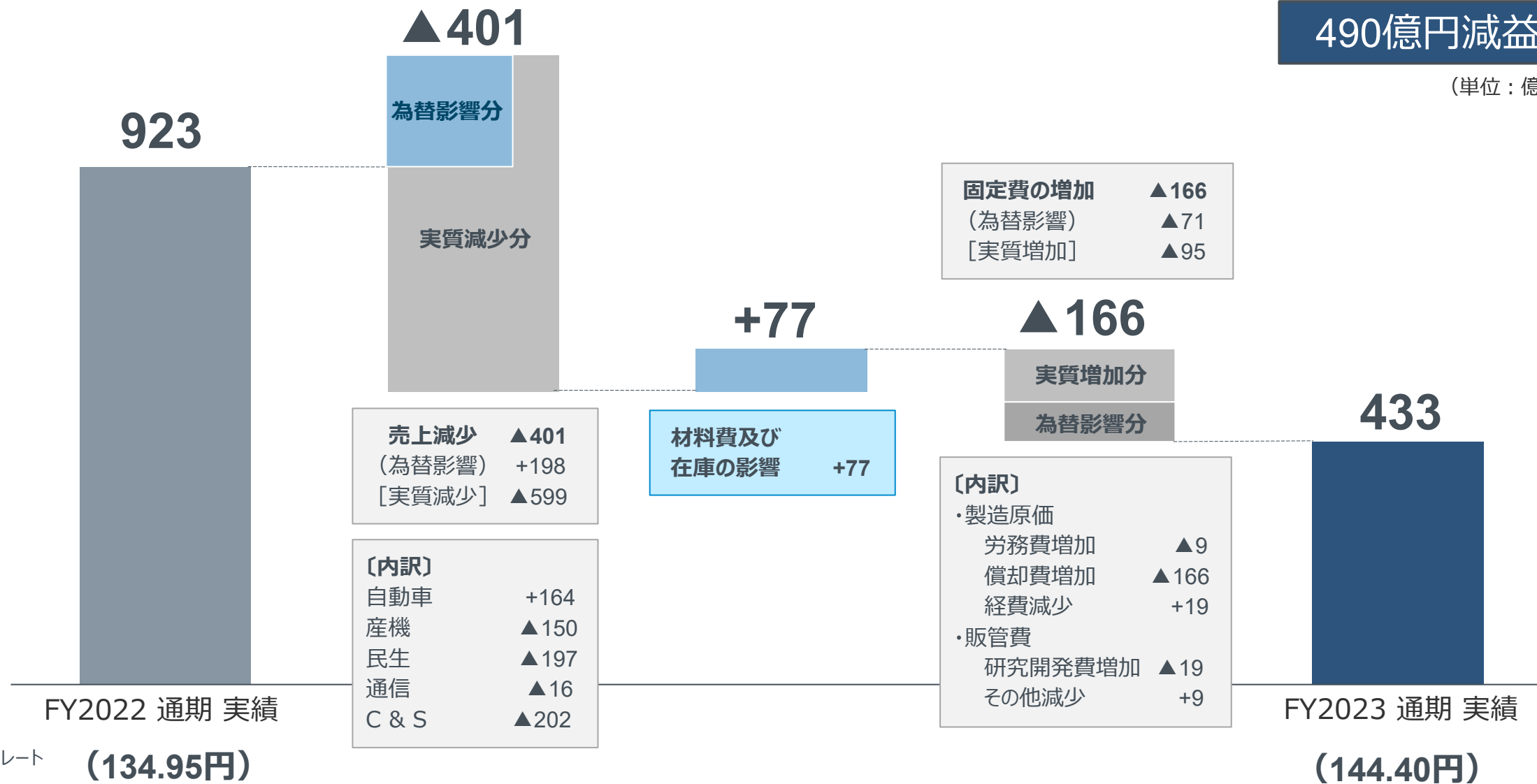


※取引先企業の国籍別 売上を集計 (単位: 億円)

2023年度 通期 営業利益 増減分析 (前年比)

490億円減益

(単位：億円)



2023年度 通期 実績 セグメント別 (前年比)

(単位：億円)

		FY2023 実績	FY2022 実績	増減額	増減率
LSI	売上	2,072	2,337	▲265	▲11.3%
	セグメント利益	212	481	▲269	▲55.8%
	(利益率)	(10.3%)	(20.6%)	-	-
半導体素子	売上	2,019	2,122	▲103	▲4.8%
	セグメント利益	129	345	▲216	▲62.5%
	(利益率)	(6.4%)	(16.3%)	-	-
モジュール	売上	329	343	▲14	▲4.1%
	セグメント利益	20	42	▲22	▲53.2%
	(利益率)	(6.1%)	(12.5%)	-	-
その他	売上	257	276	▲19	▲6.9%
	セグメント利益	21	50	▲29	▲57.7%
	(利益率)	(8.4%)	(18.4%)	-	-

2024年度 通期 計画 (前年比)

(単位：億円)

	FY2024 計画	FY2023 実績	増減額	増減率
売上高	4,800	4,677	+123	+2.6%
営業利益	140	433	▲293	▲67.7%
(対売上比率)	(2.9%)	(9.3%)	-	-
経常利益	180	692	▲512	▲74.0%
(対売上比率)	(3.8%)	(14.8%)	-	-
純利益	140	539	▲399	▲74.1%
(対売上比率)	(2.9%)	(11.5%)	-	-
EBITDA	1,067	1,153	▲86	▲7.5%
(対売上比率)	(22.2%)	(24.7%)	-	-

期中平均レート(¥/US\$)

(145.49円)

(144.40円)

期末レート(¥/US\$)

(145.00円)

(151.41円)

2024年度 ローム売上見通しサマリ

【YoY】
前年比



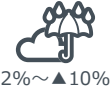
+10%~



+10%~+2%



+2%~▲2%



▲2%~▲10%



▲10%~

市場	今後の見通し	上期	下期
自動車 (+10.8%)	<ul style="list-style-type: none"> ■ BEVの成長率が鈍化するものの、2024年も堅調維持。自動車生産台数も増加 ■ 電動化・電装化の促進、在庫調整も収束され、パワー・アナログ製品を中心に安定成長を見込む ■ 特にxEV、パワートレイン、ボディ関連におけるパワーデバイスが好調 		
産機 (▲12.1%)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 上期は在庫調整による需要低迷が継続し、製品・分野問わず全体として減少傾向 ■ 下期以降、エネルギー関連は回復へ向かうが、上期の減少幅が大きく、通期では減少の見込 ■ FAも下期から回復基調ではあるが、戻りとしては弱い 		
民生 (▲1.4%)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 下期以降にエアコンなどの家電を中心に全体として回復が見込まれる 		
通信 (▲14.1%)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 通信市場向け売上の大半を占めるスマホは、年間通して減少傾向 		
コンピュータ& ストレージ (+1.2%)	<ul style="list-style-type: none"> ■ 生成AIやPC更新需要などを背景に、PC&サーバー関連の回復期待が高まる 		

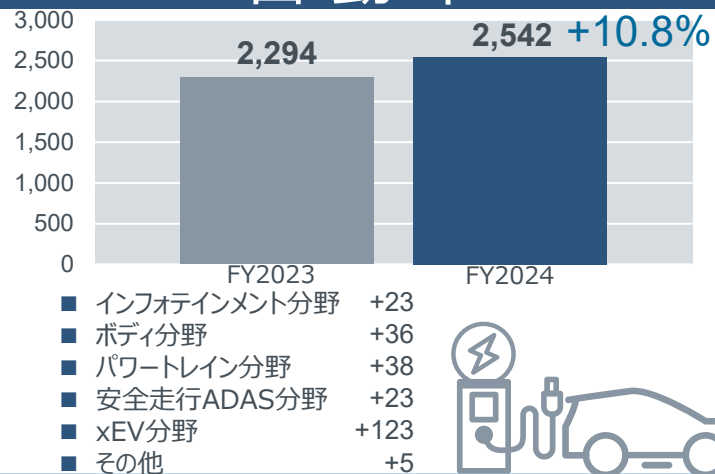
2024年度 通期計画 市場別 売上の変動要因 (前年比)

(単位：億円)

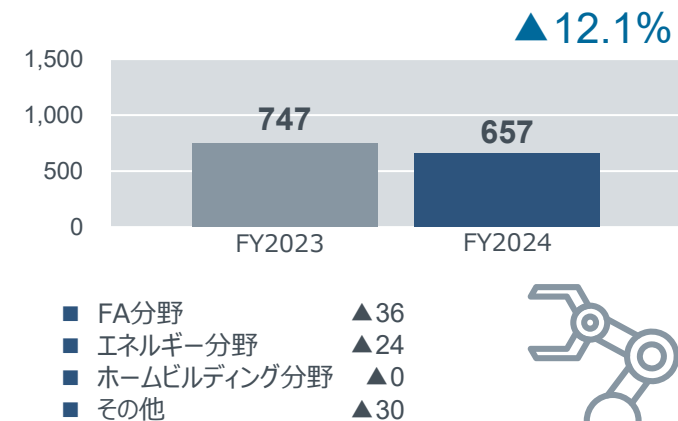
通期売上高

4,677億円 +2.6%
 FY2023 通期実績 FY2024 通期計画

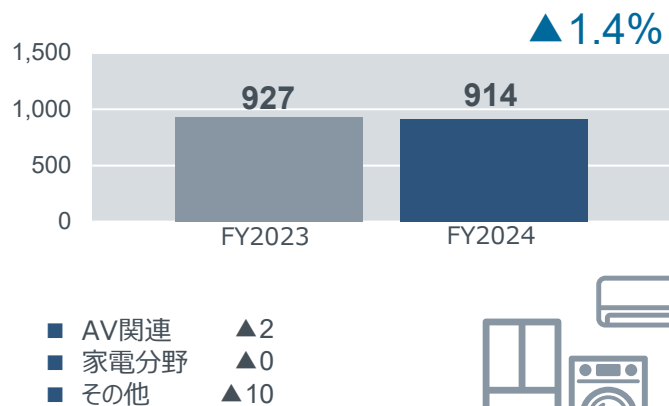
自動車



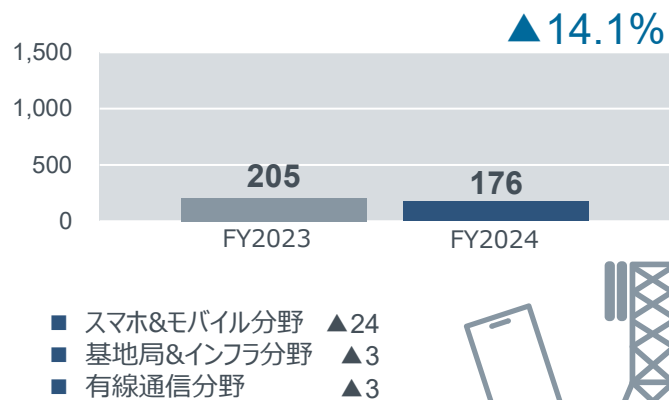
産機



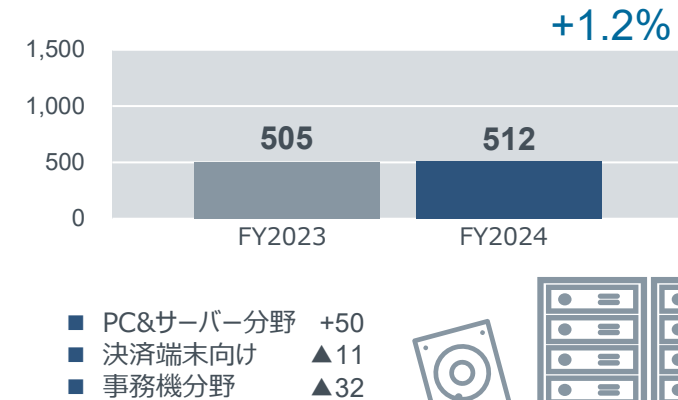
民生



通信



コンピュータ & ストレージ



2024年度 通期計画 国籍別 売上の変動要因 (前年比)

通期売上高

4,677億円

4,800億円

FY2023 通期実績

FY2024 通期計画

+2.6%

海外売上高比率

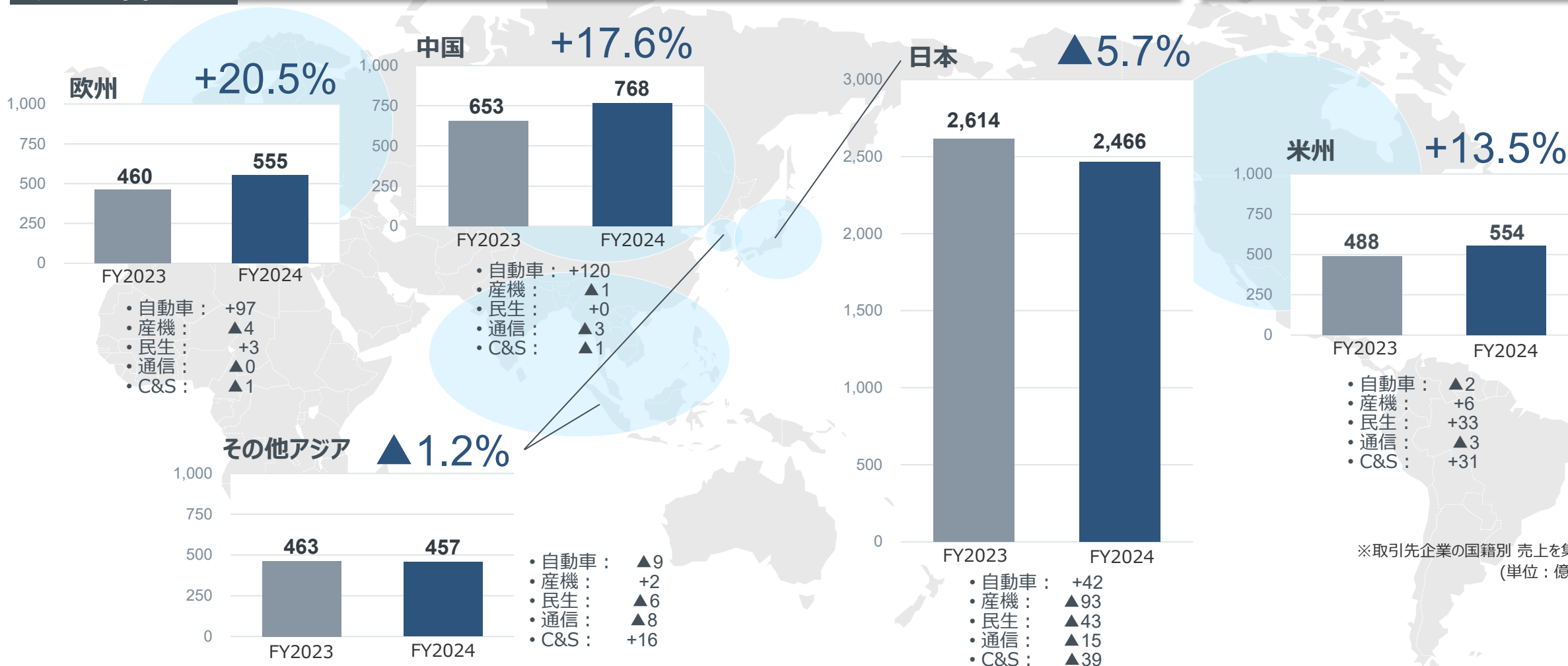
44.1%

FY2023 通期

48.6%

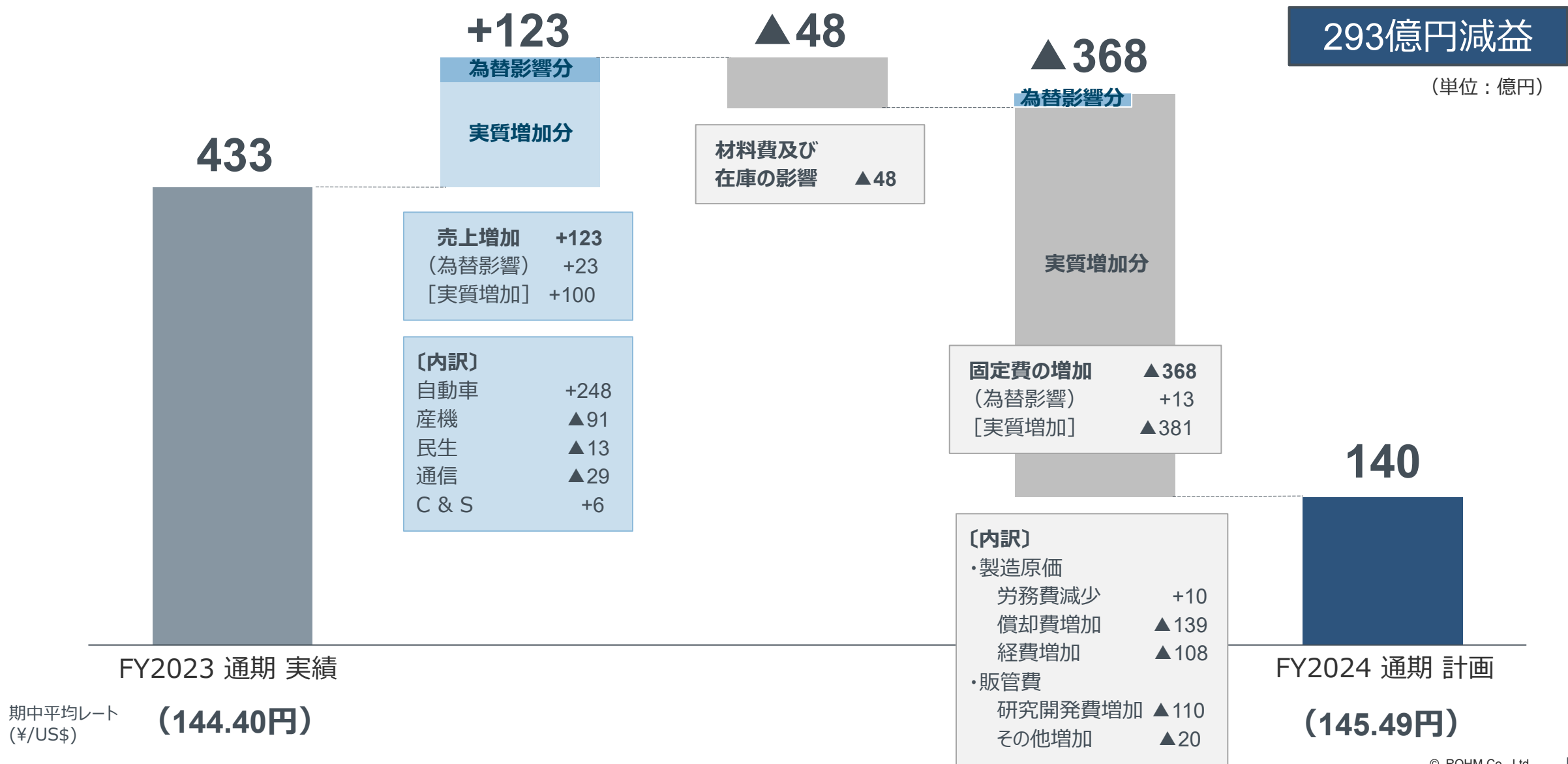
FY2024 通期

通期計画 前年比

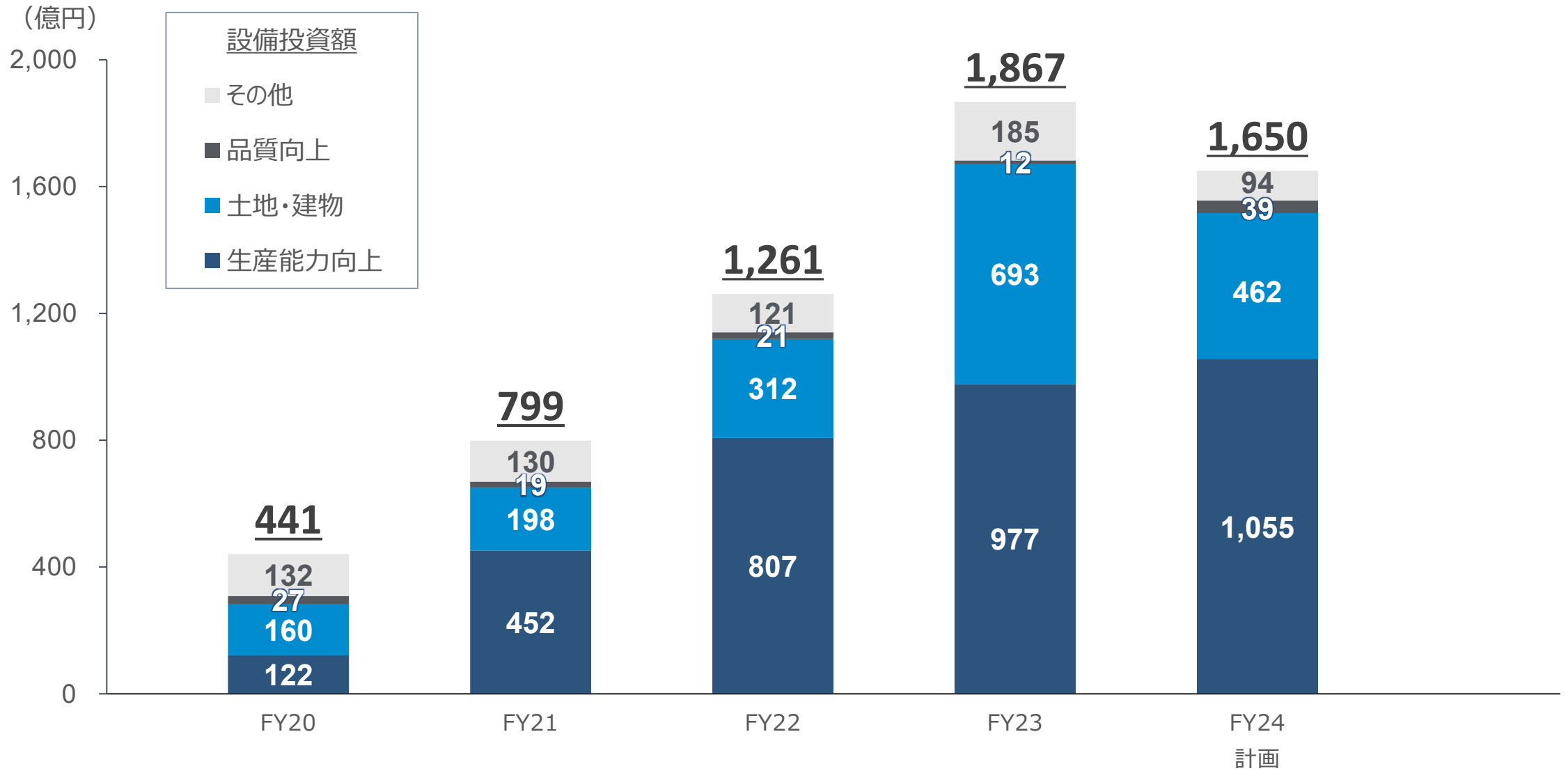


※取引先企業の国籍別 売上を集計 (単位: 億円)

2024年度 通期計画 営業利益 増減分析 (前年比)

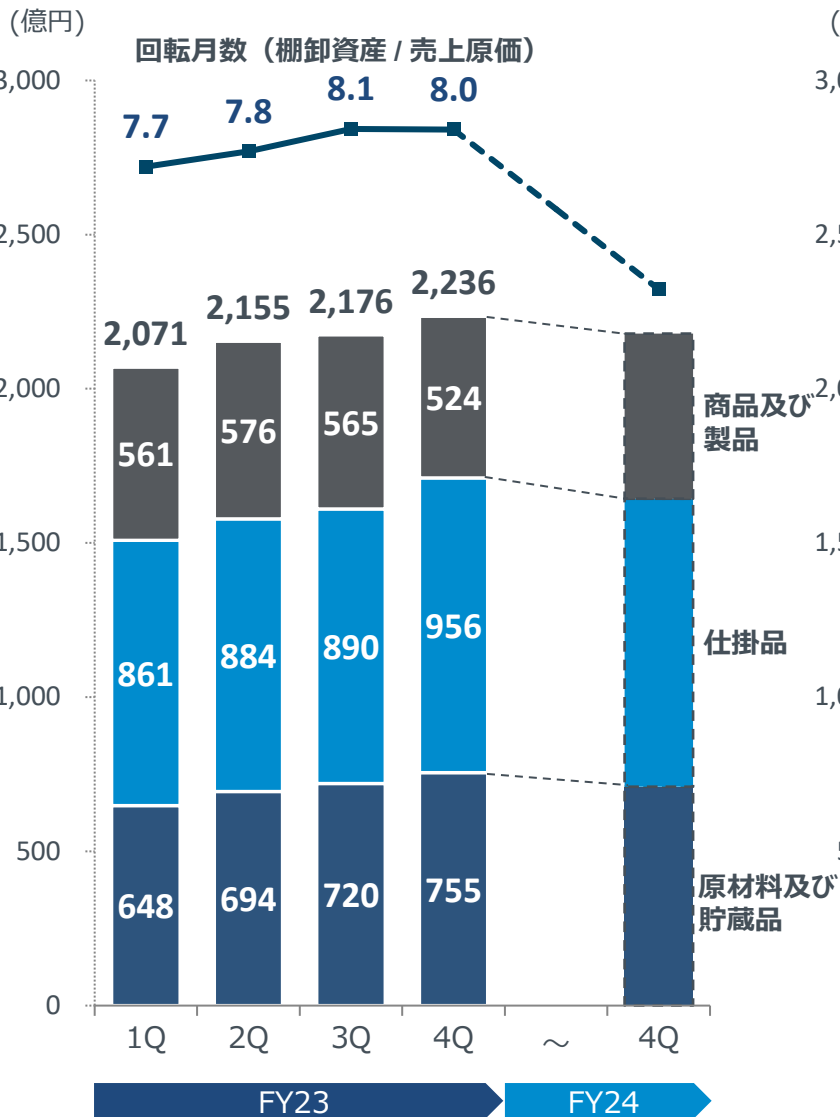


設備投資の状況

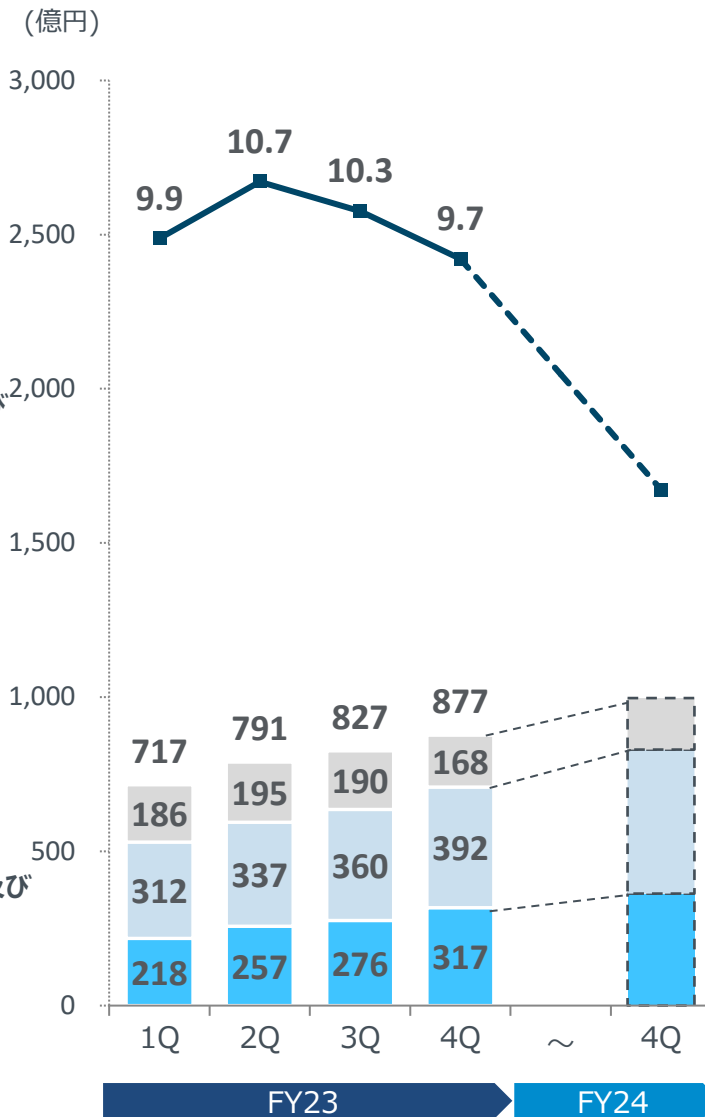


在庫の状況 (金額)

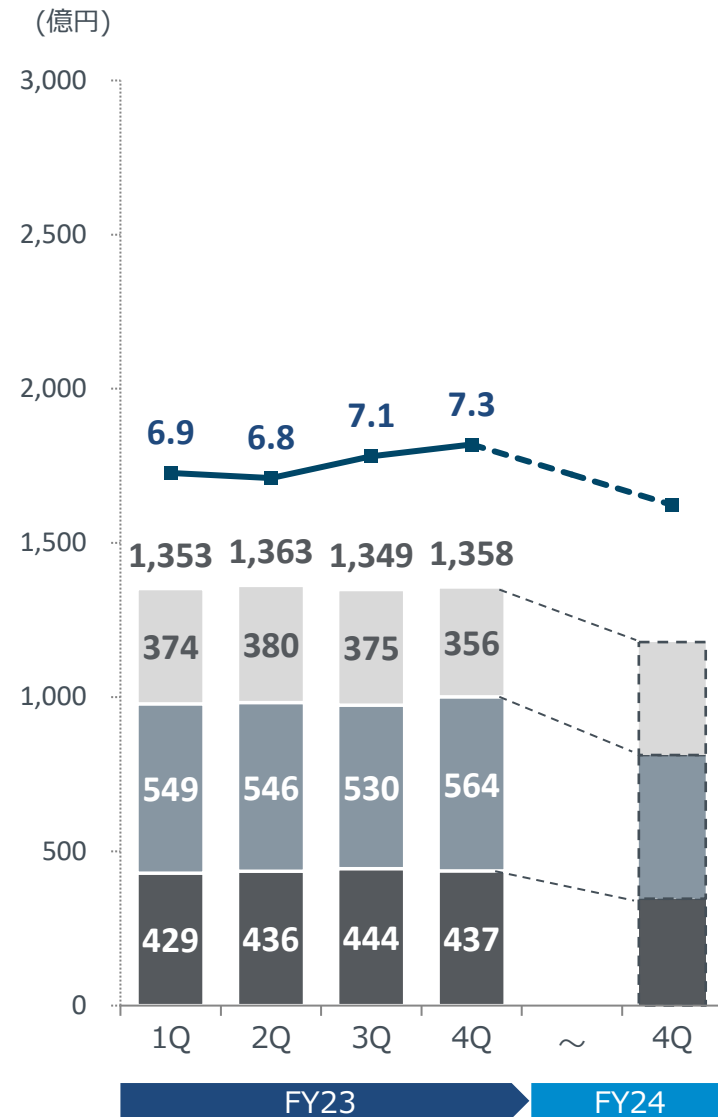
連結合計

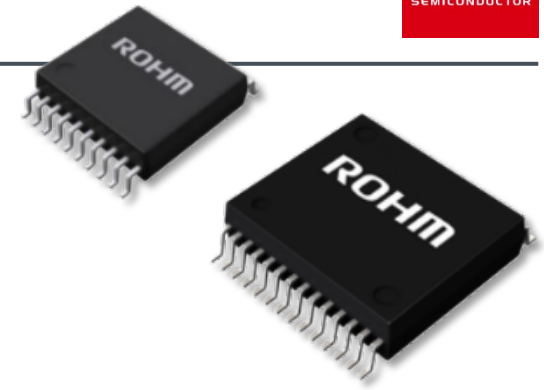


パワーデバイス



パワーデバイス以外

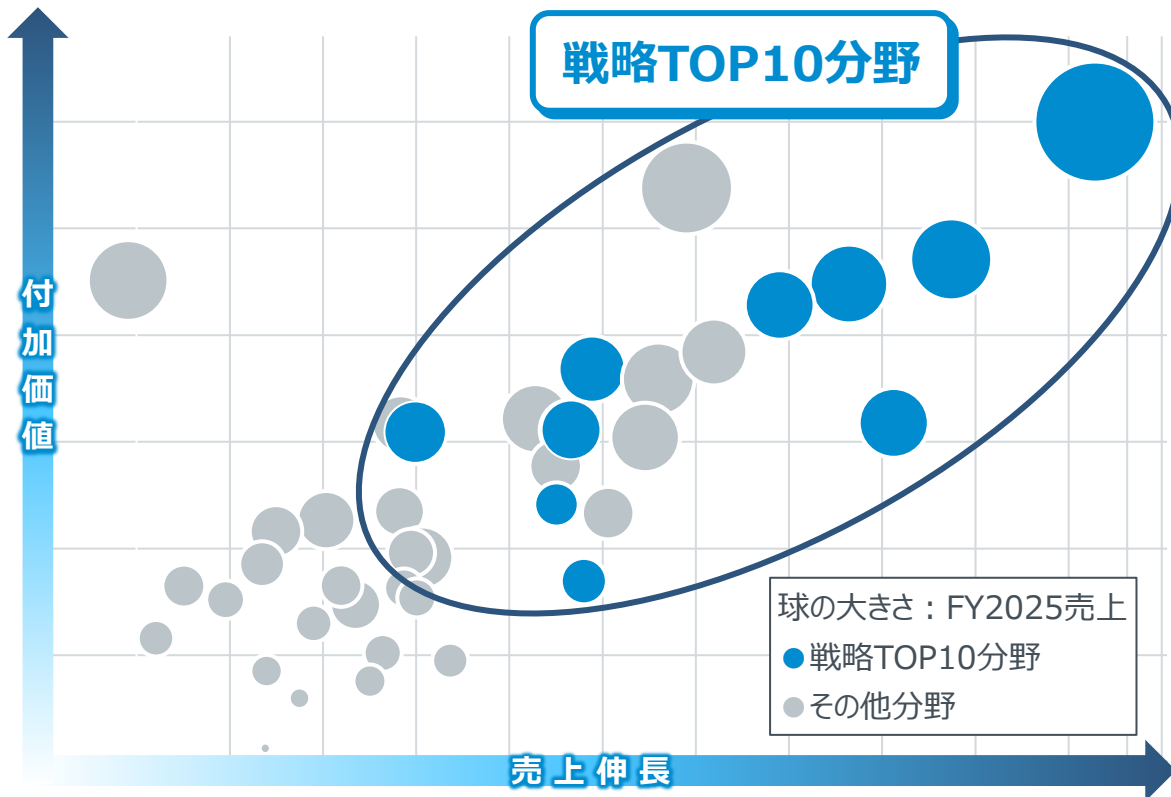




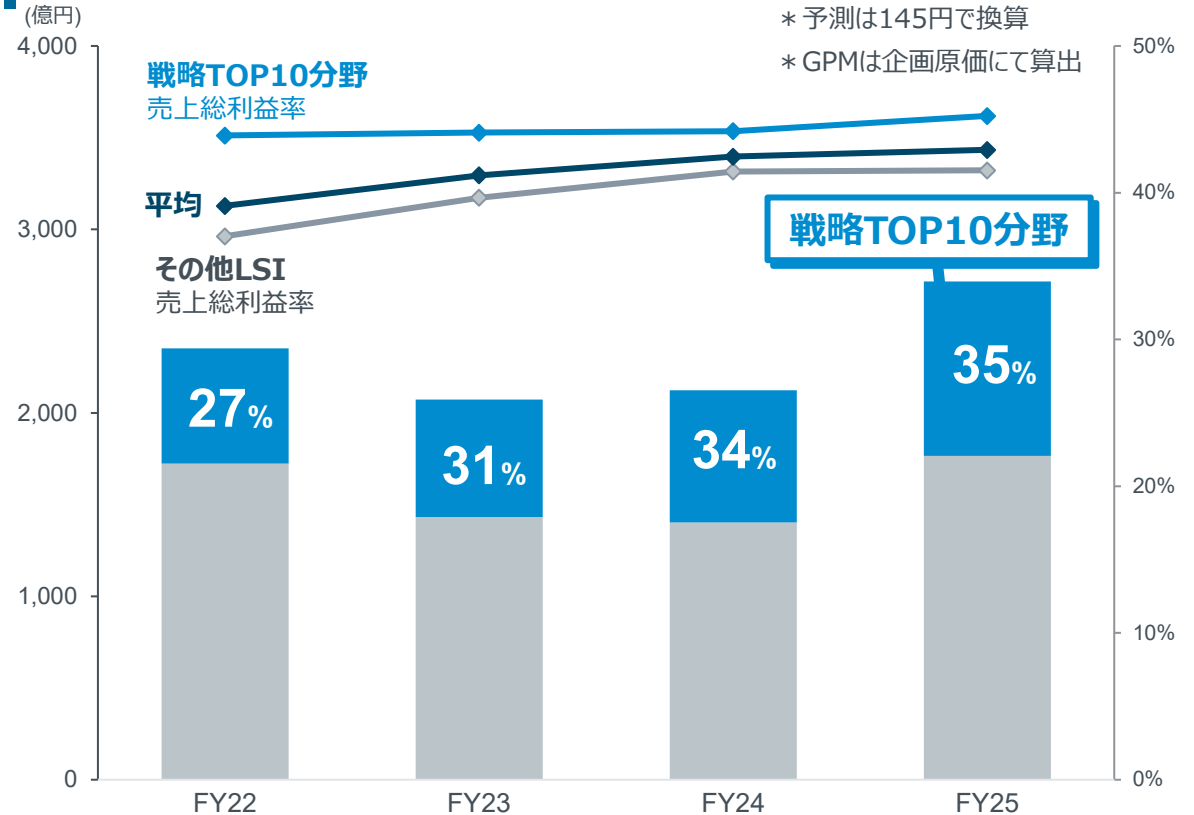
ASSP製品においては戦略TOP10分野を開発・サポート拡充

売上伸長・付加価値のあるASSP分野のTOP10を戦略TOP10分野とし、戦略TOP10分野の売上構成比を上げ、売上・利益拡大を図る。

ポートフォリオ (戦略TOP10分野)



売上比率・売上総利益率 (戦略TOP10分野)



注力分野である車載向けソリューションで売上拡大

電装化・電動化の向上により、更なる成長が期待できる車載向け市場において、付加価値のある製品を継続して投入。
海外顧客向け売上を高め、車載全体の売上規模を拡大。



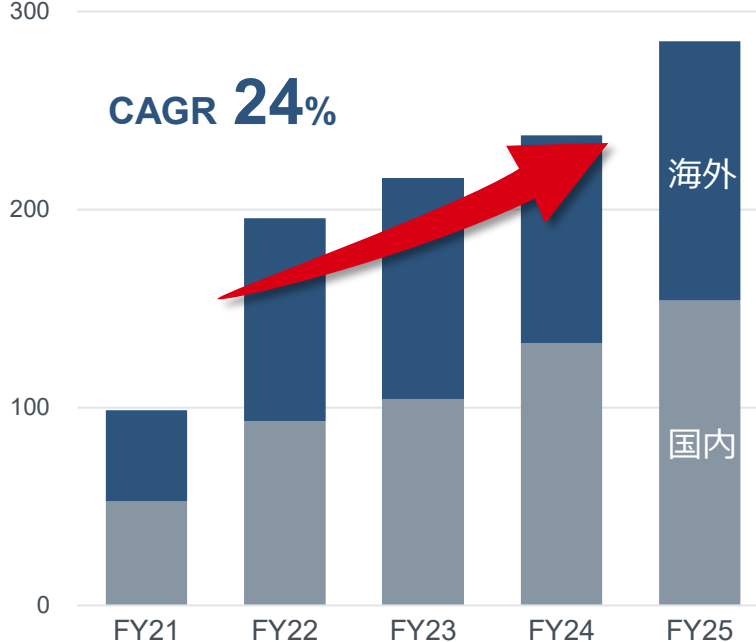
LEDドライバ

(億円)



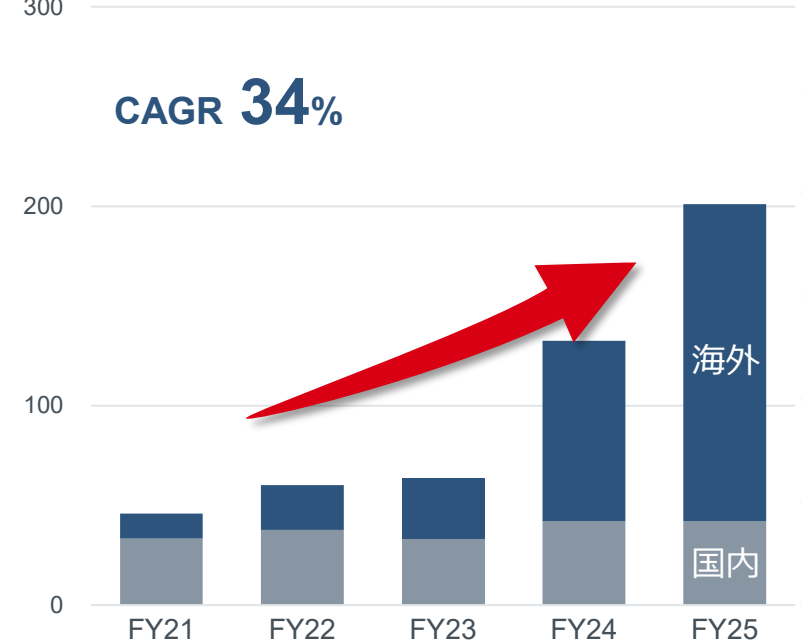
絶縁ゲートドライバ

(億円)



ADASソリューション (SerDes+AFE+PMIC)

(億円)

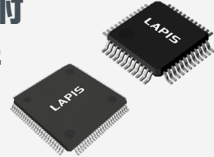


* 予測は145円で換算

業界実績を持つパワーデバイスにMCU・制御技術を加え、高効率なソリューションを実現
MCUレス制御にMCU制御を加え、中・大電力帯向けにもソリューションをご提供

MCU

- U8/U16
- Arm® Cortex® -M0+/M3/M33
- 高速・高集積回路コア技術
- 低消費電力回路コア技術
- ソフトウェア制御技術



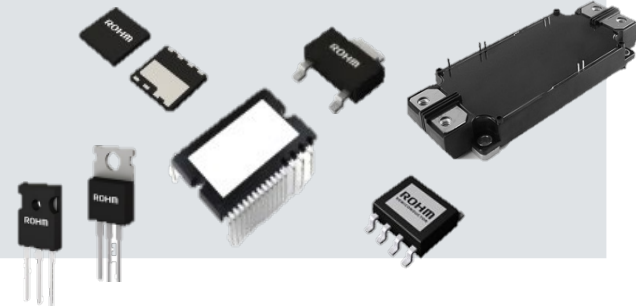
制御技術

- ゲート駆動制御技術



パワーデバイス

- SiC/SiCモジュール
- インテリジェントパワーデバイス(IPD)
- MOSFET/バイポーラトランジスター
- IGBT
- GaN



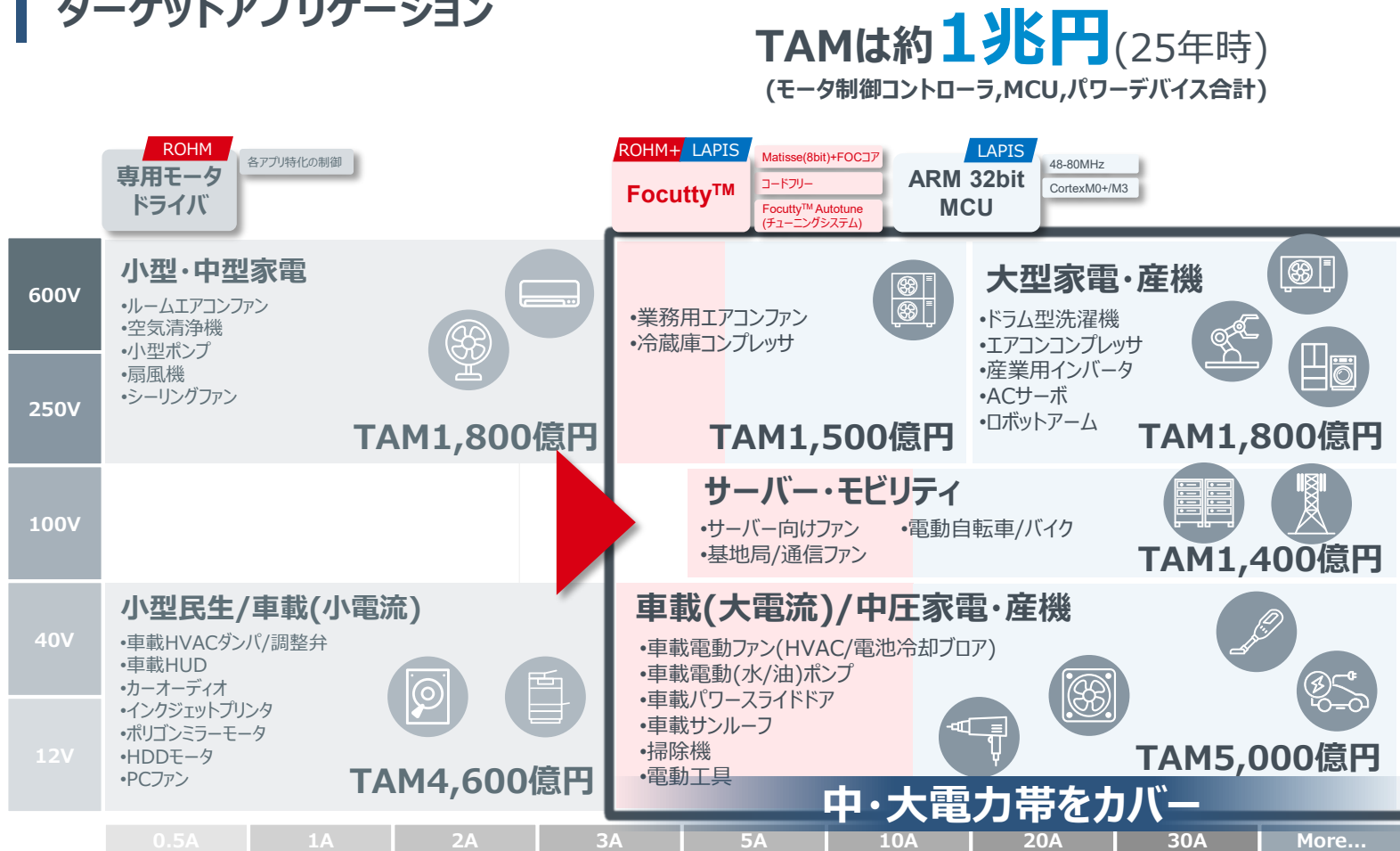
高付加価値製品開発

【メリット】

- 制御自由度が高くタイムリーな仕様変更が可能
- ASSP化を進めやすい
- ソフトウェアで製品付加価値を高めることができる

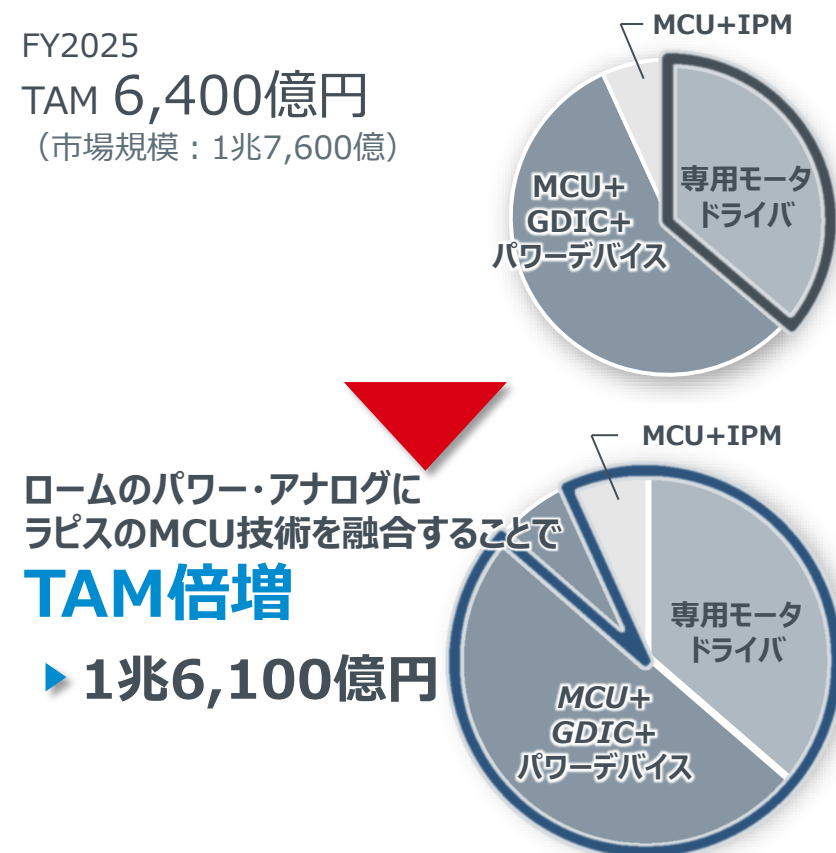
パワーデバイス+MCU+制御技術のすり合わせによる高付加価値ソリューション提案を加速させることにより ロームシェアを上げていく

ターゲットアプリケーション



モータ制御+パワーデバイス市場金額

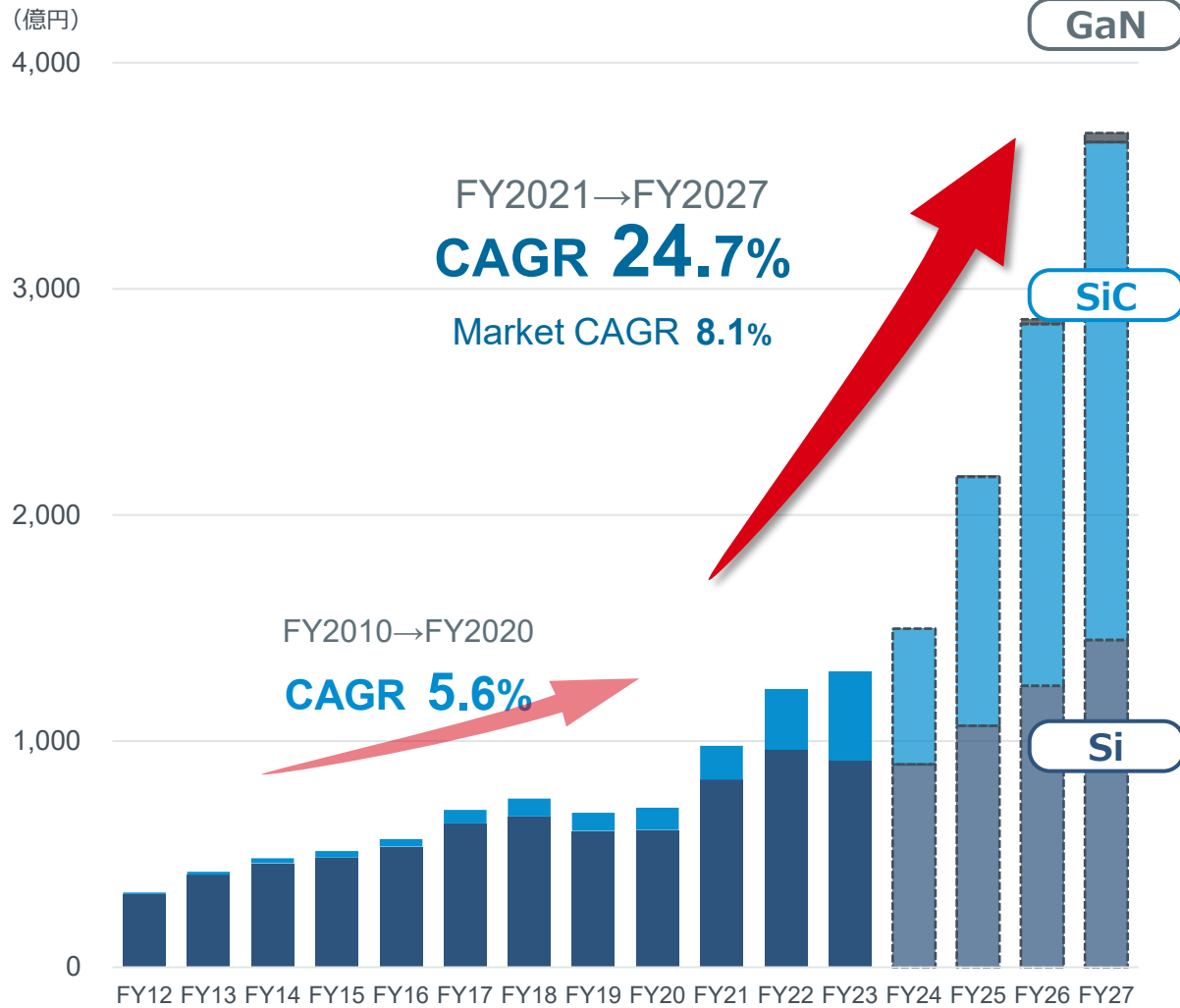
FY2025
TAM 6,400億円
(市場規模: 1兆7,600億)



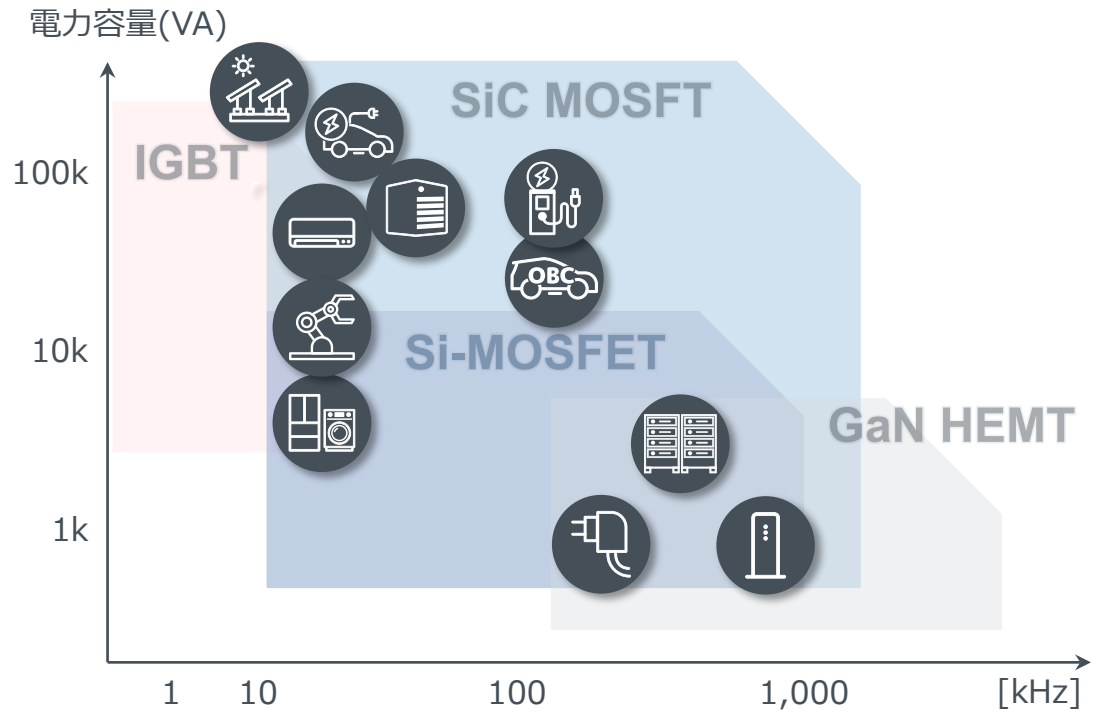
*注釈: TAM(FY2025)はローム試算。

引用元: 精密小型モータ市場領域における応用機器別・部材別市場の将来展望(富士経済)/ローム試算

パワーデバイス事業の売上目標



パワーデバイスのアプリケーション適用範囲



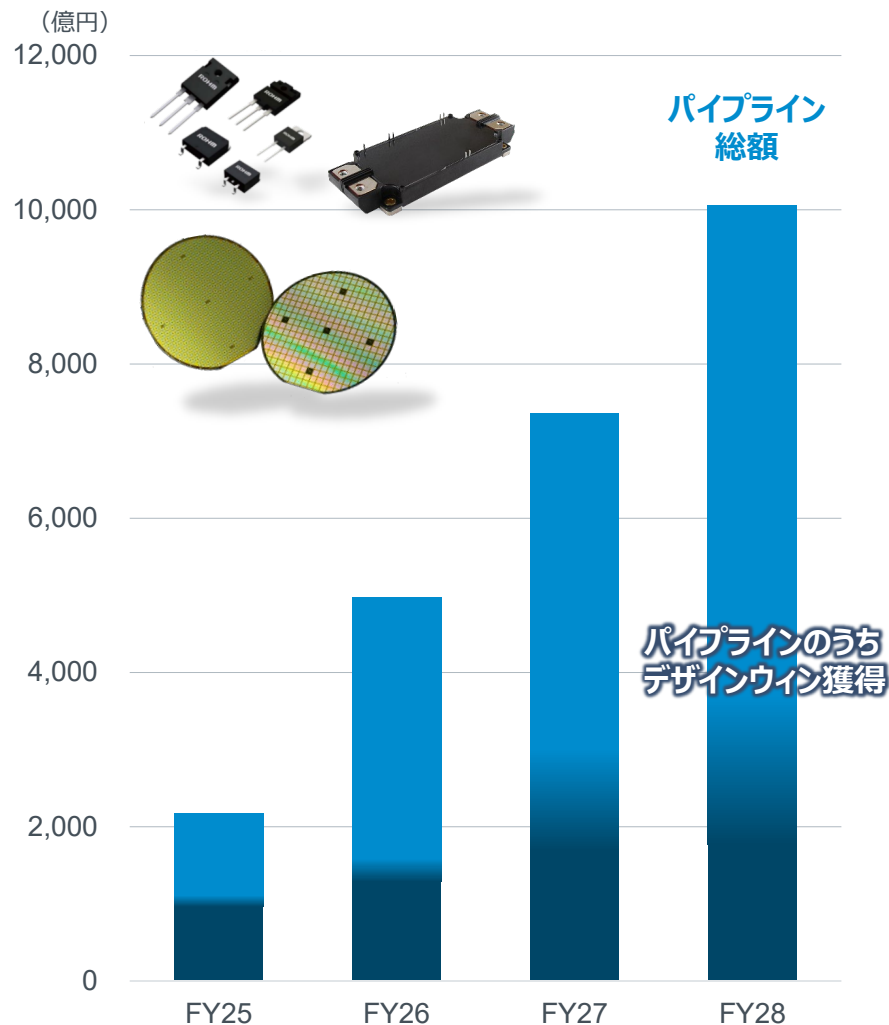
SiC

- 大電力
- 高電圧(> 600V)
- 高周波(20~200kHz)

GaN

- 中電力
- 中電圧(100~600V)
- 高周波(200kHz以上)

SiC事業のパイプライン（新規+既存）



SiC事業の目標

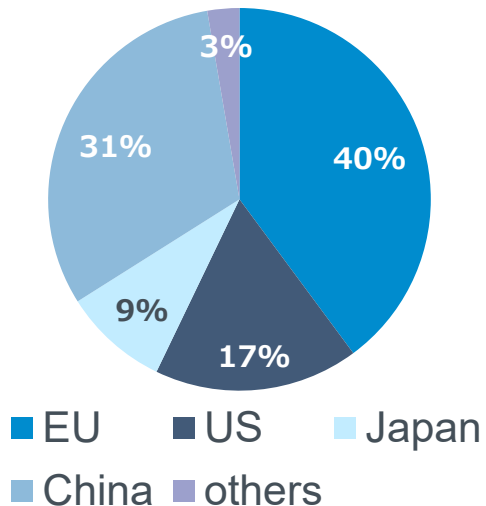
売上目標

> 1,100億円 (FY2025) > 2,200億円 (FY2027)

* 145円で換算

ワールドワイドでバランスよく、
すでに130社以上でデザインウィンが確定

2027年（金額ベース）

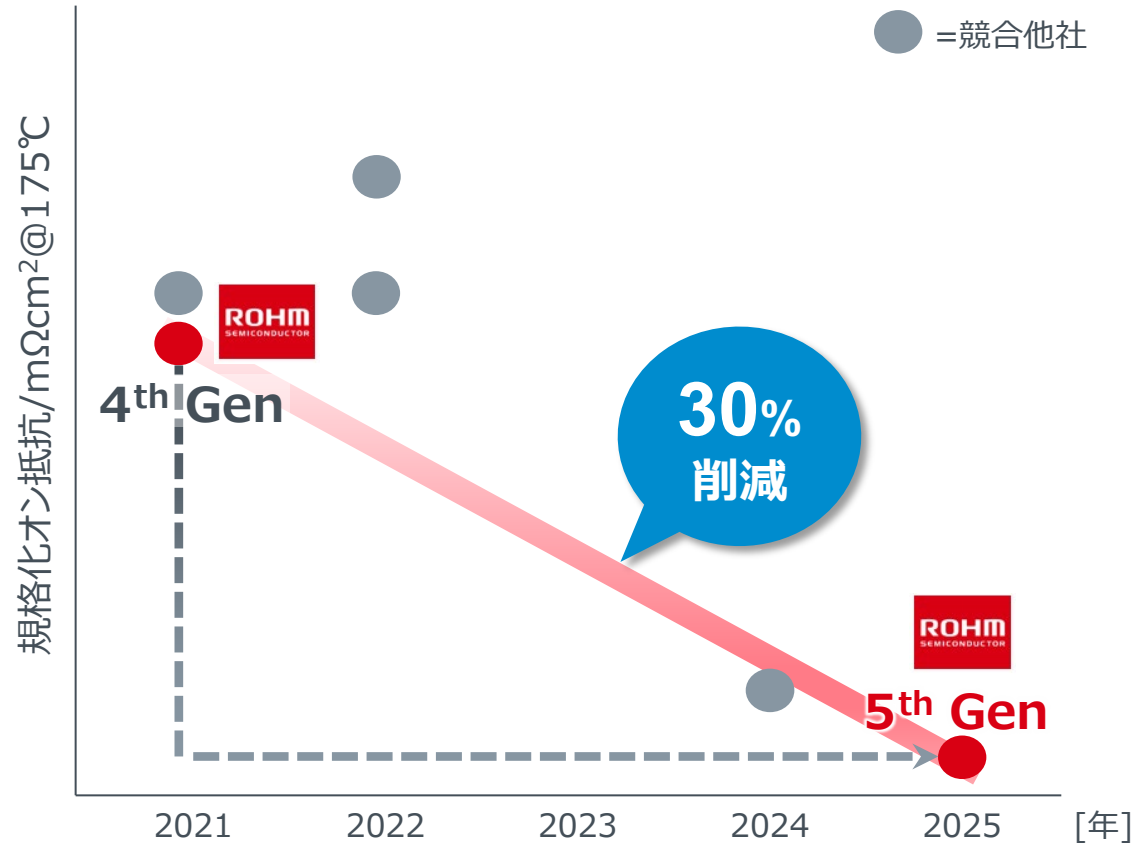


地域	DW獲得社数
欧州	24
米州	14
日本	43
中国	39
その他	18

第5世代SiC-MOSデバイスを8インチ基板で生産することで、競争力を大きく向上させる

1200V MOSFETベンチマーク

第5世代MOSFETは高温時のオン抵抗を現行世代比**30%削減**



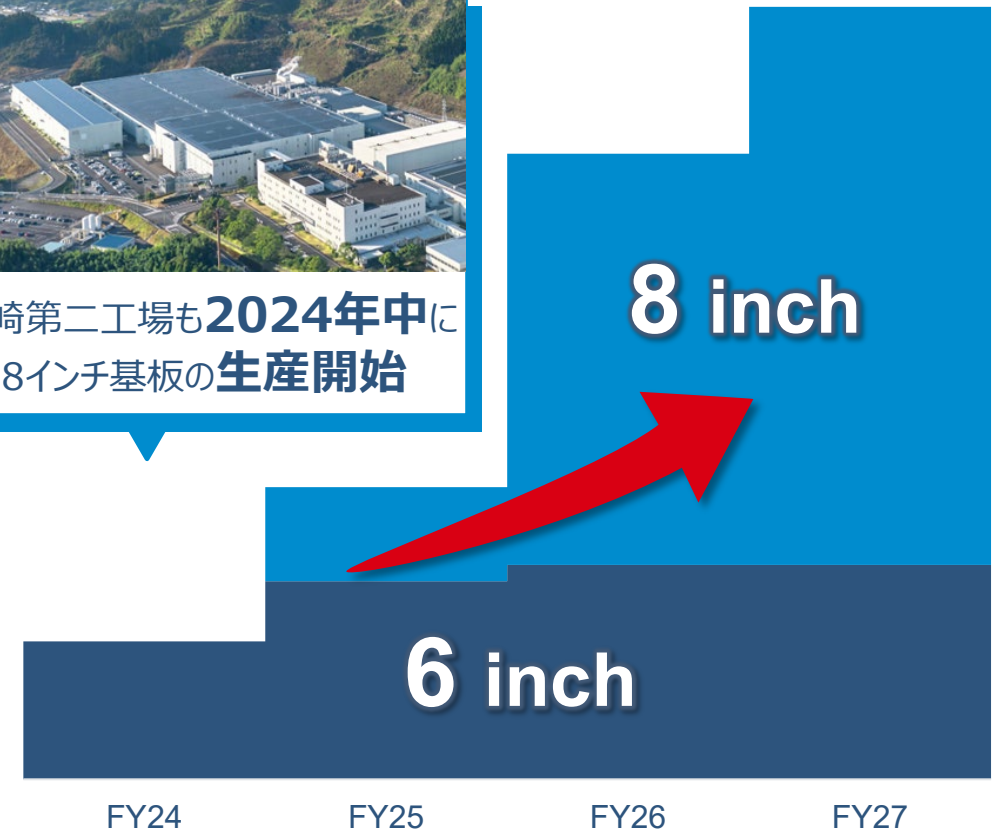
プロット：リリース時期と性能を示す

8インチ化

筑後工場 8インチラインにて**2025年より供給開始**



宮崎第二工場も**2024年中**に
8インチ基板の**生産開始**



インバータの電力密度向上に貢献できる モールドモジュール TRCDRIVE PACK™ (ティーアールシードライブ) のデファクト化を目指す

ロームのパワーモジュール事業

- 2015年 世界で初めて車載パワートレイン向けにフルSiC-IPMの量産開始 (ケースタイプモジュール)
- 2024年 モールドモジュール TRCDRIVE PACK™の量産開始

IPM: Intelligent Power Module

投資効率向上にも貢献できる
SiCパワーモジュール事業の売上目標

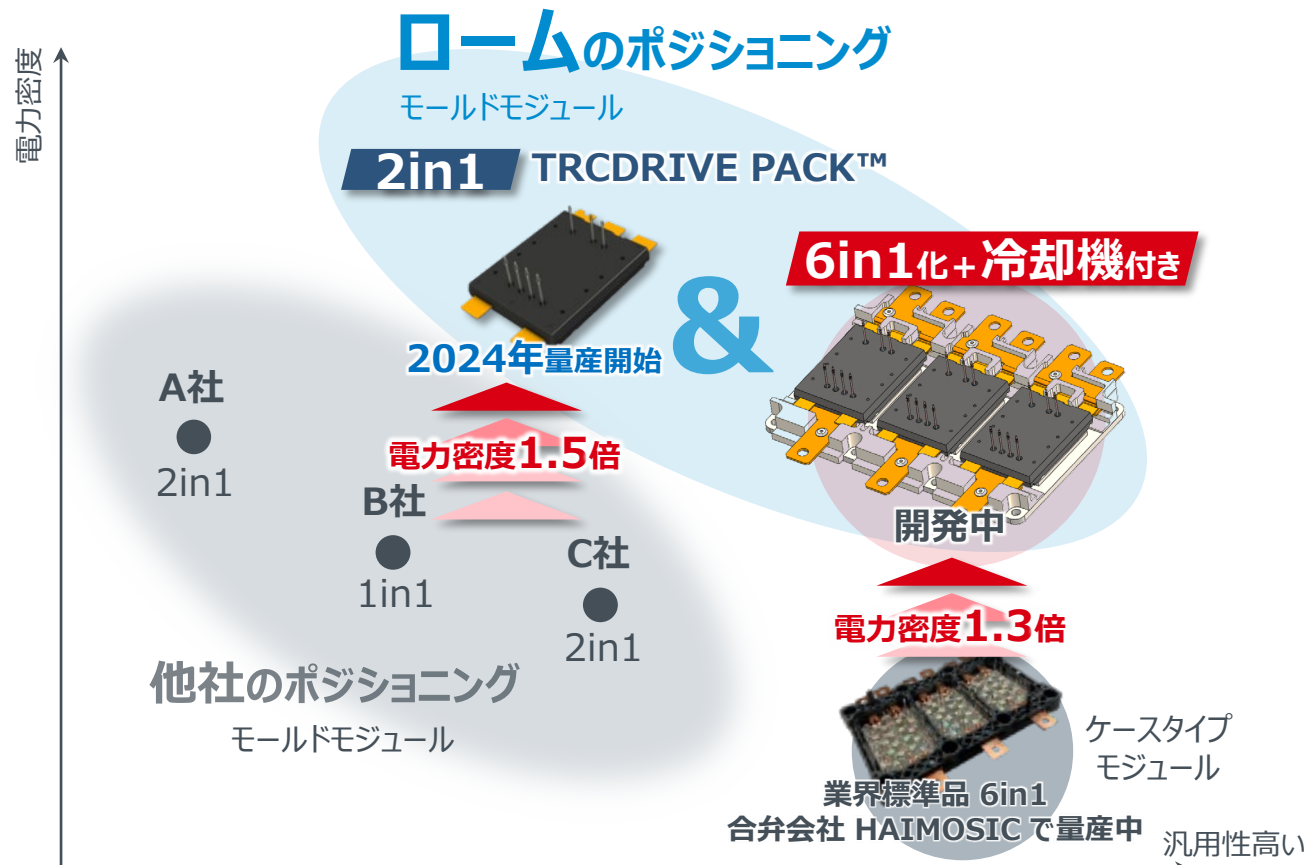
売上目標

FY2027

>600億円

* 145円で換算

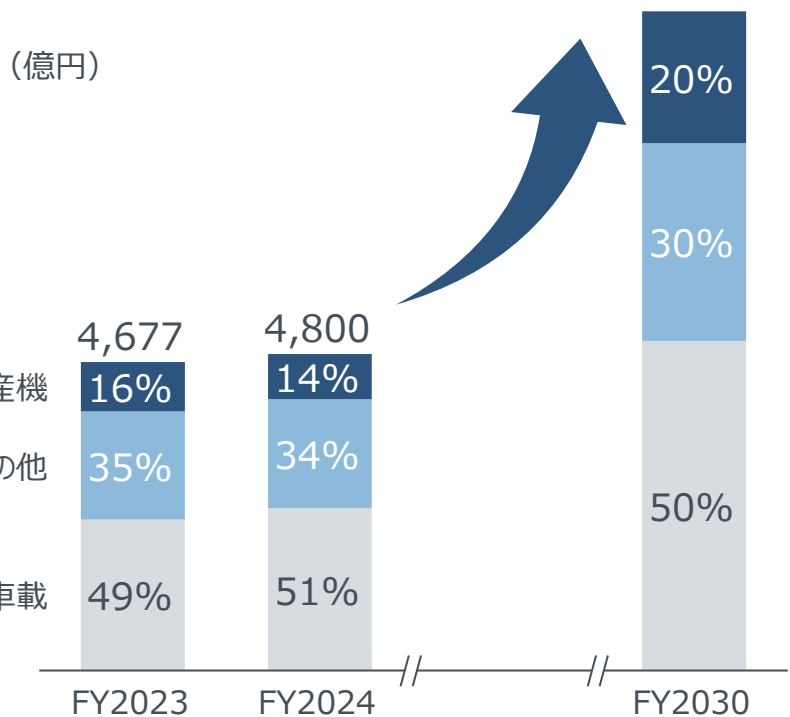
21社でデザインイン、3社でデザインウイン



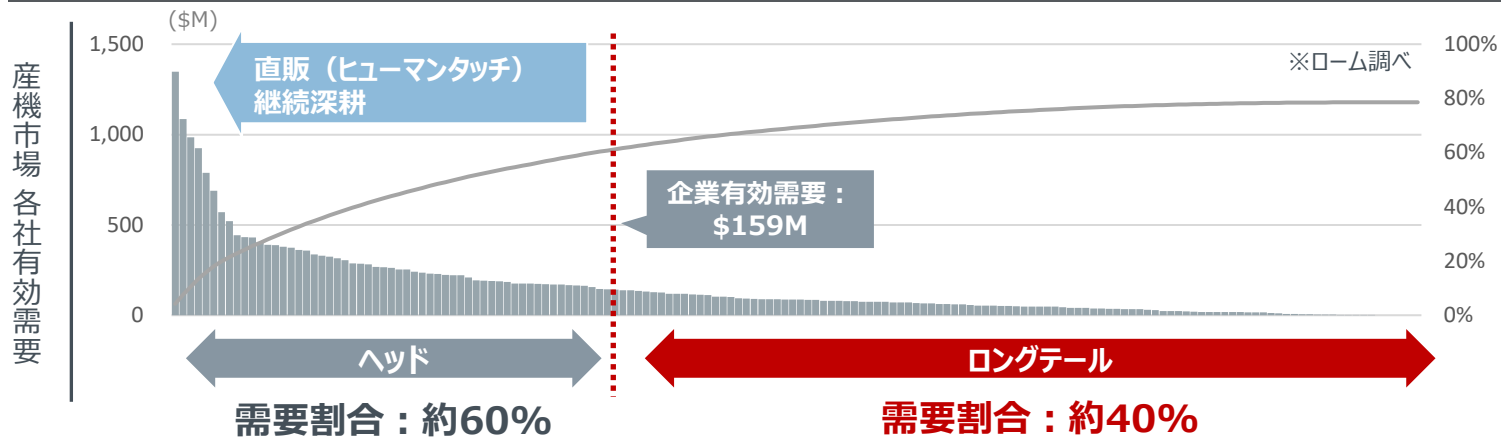
ブロードマーケットへのタッチポイントをDXにより拡大し、ロームファンを飛躍的に増やす

市場売上比率グラフ

2030年グローバルメジャーに向けた
ポートフォリオ最適化
産業機器市場比率20%以上を目指す



ブロードマーケットへエンジニアリングサポートを提供する新プラットフォームをリリース



先行リリース済

- 長期供給プログラム 2023年7月 新規オープン
- クロスリファレンス (製品検索) 2024年4月 アップデート



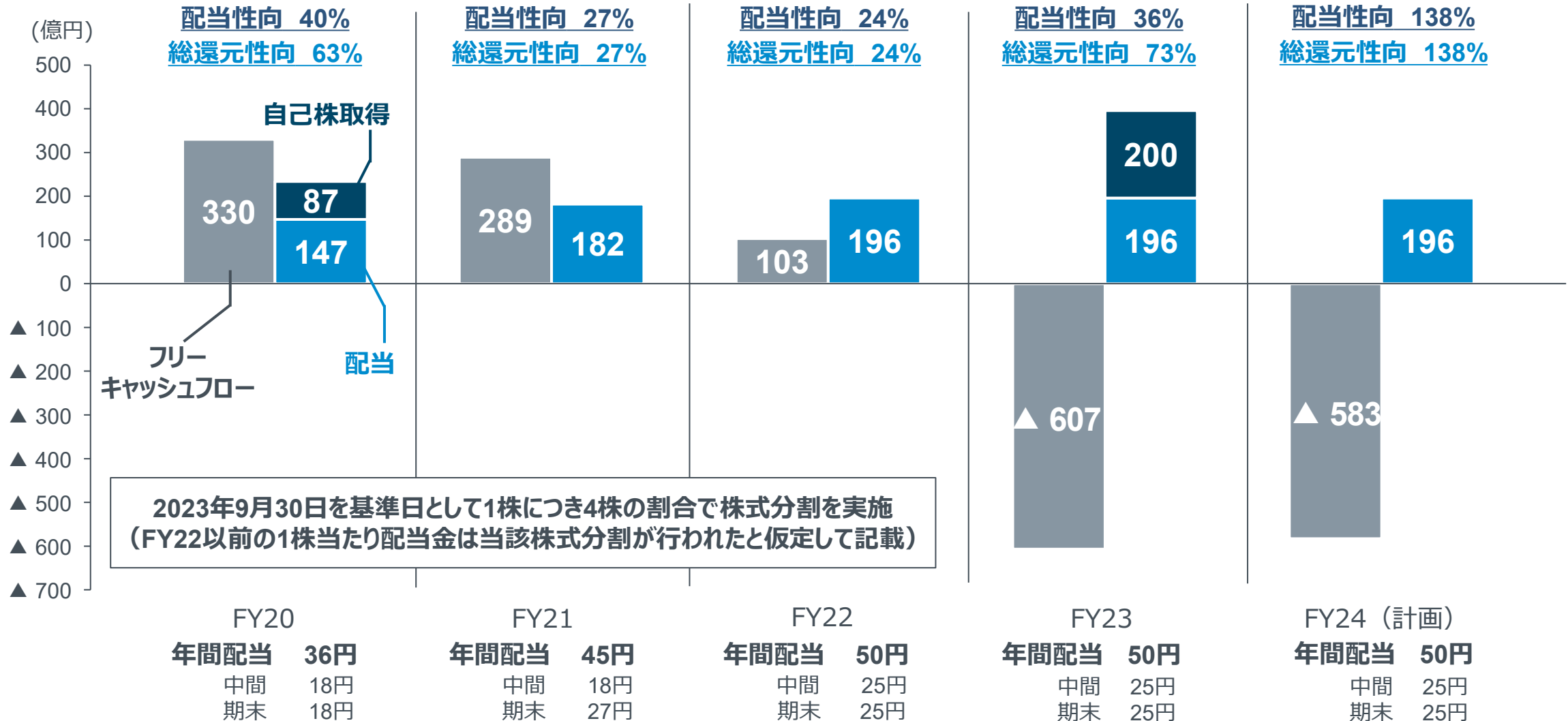
新規ターゲット
DX=テクニカルタッチ

24年7月ローンチ予定

Engineer Social Hub

- フォーラム/コミュニティ
- FAQ
- 有人チャット
- チャットボット
- お問い合わせ

株主還元の推移



*フリーキャッシュフロー：純利益 + 減価償却費 - 設備投資

中期経営計画の進捗

中期経営計画(MOVING FORWARD to 2025)

2021年度～2025年度

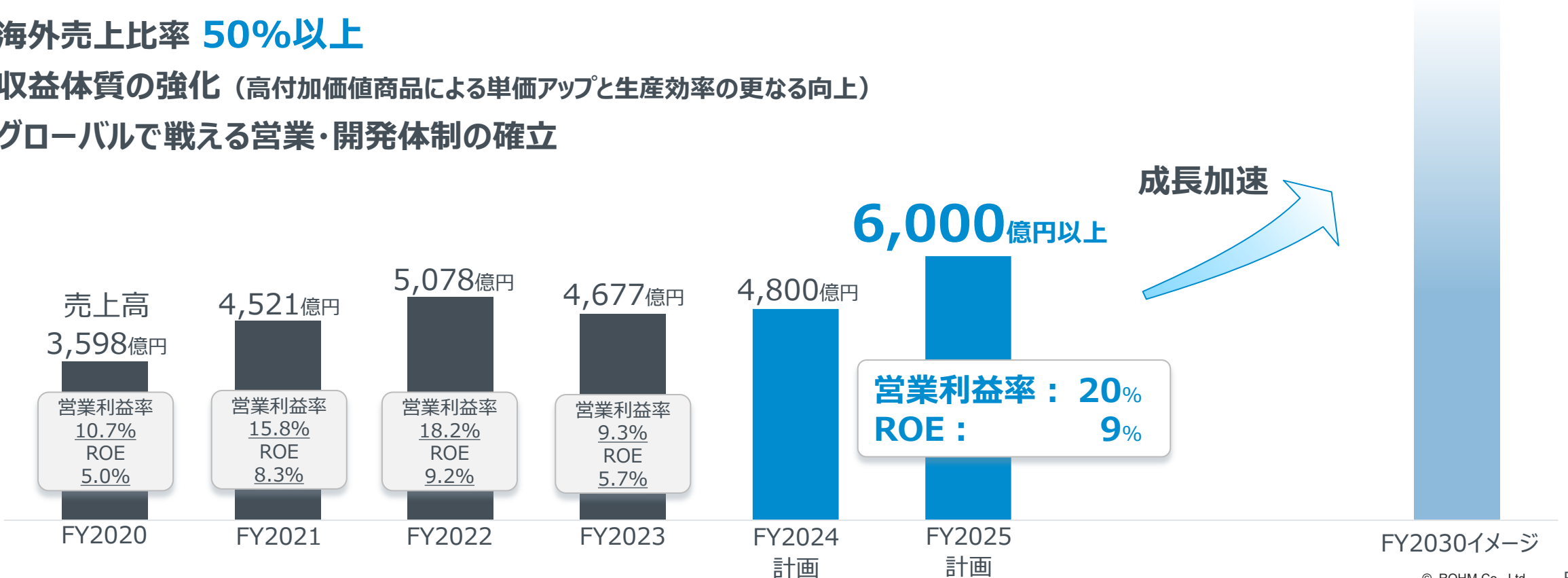
2030年度

"車載" "海外" での成長実現と更なる成長に向けた基盤作り

グローバルメジャーへ

- 成長軌道へ戻す5年
- 電動車市場でグローバルトップシェア商品の確立 (SiC、絶縁ゲートドライバ)
- 海外売上比率 **50%以上**
- 収益体質の強化 (高付加価値商品による単価アップと生産効率の更なる向上)
- グローバルで戦える営業・開発体制の確立

パワー・アナログ分野で世界Top10
 全社売上1兆円を目指す



財務目標

売上高 **6,000**億円以上

営業利益率 **20%**以上

ROE **9%**以上

非財務目標 (抜粋)

環境 (2030年度)

- 温室効果ガス排出量**50.5%**削減 (2018年度比)
- 再生可能エネルギー
2050年度導入比率100%へ向け推進
- 廃棄物ゼロエミッション化

ダイバーシティ、従業員

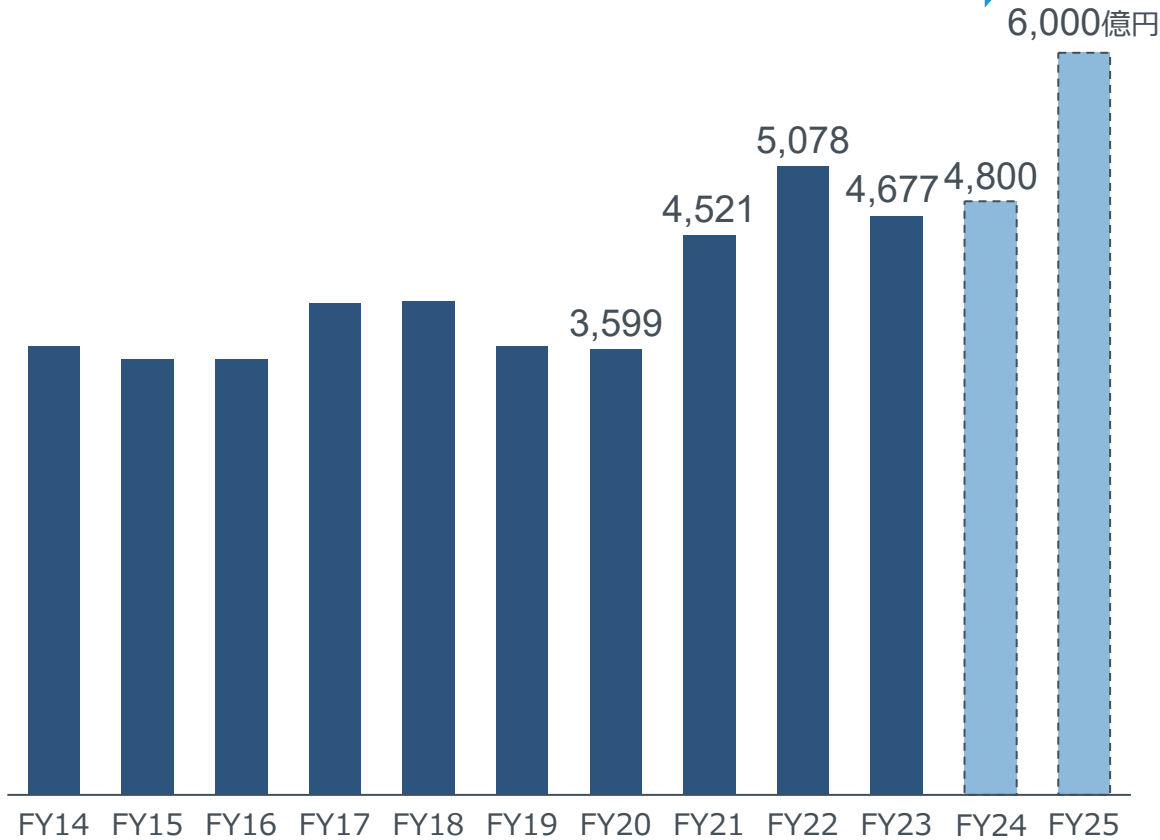
- グローバル女性管理職比率15%
- 従業員エンゲージメントスコア業界平均以上

お客様

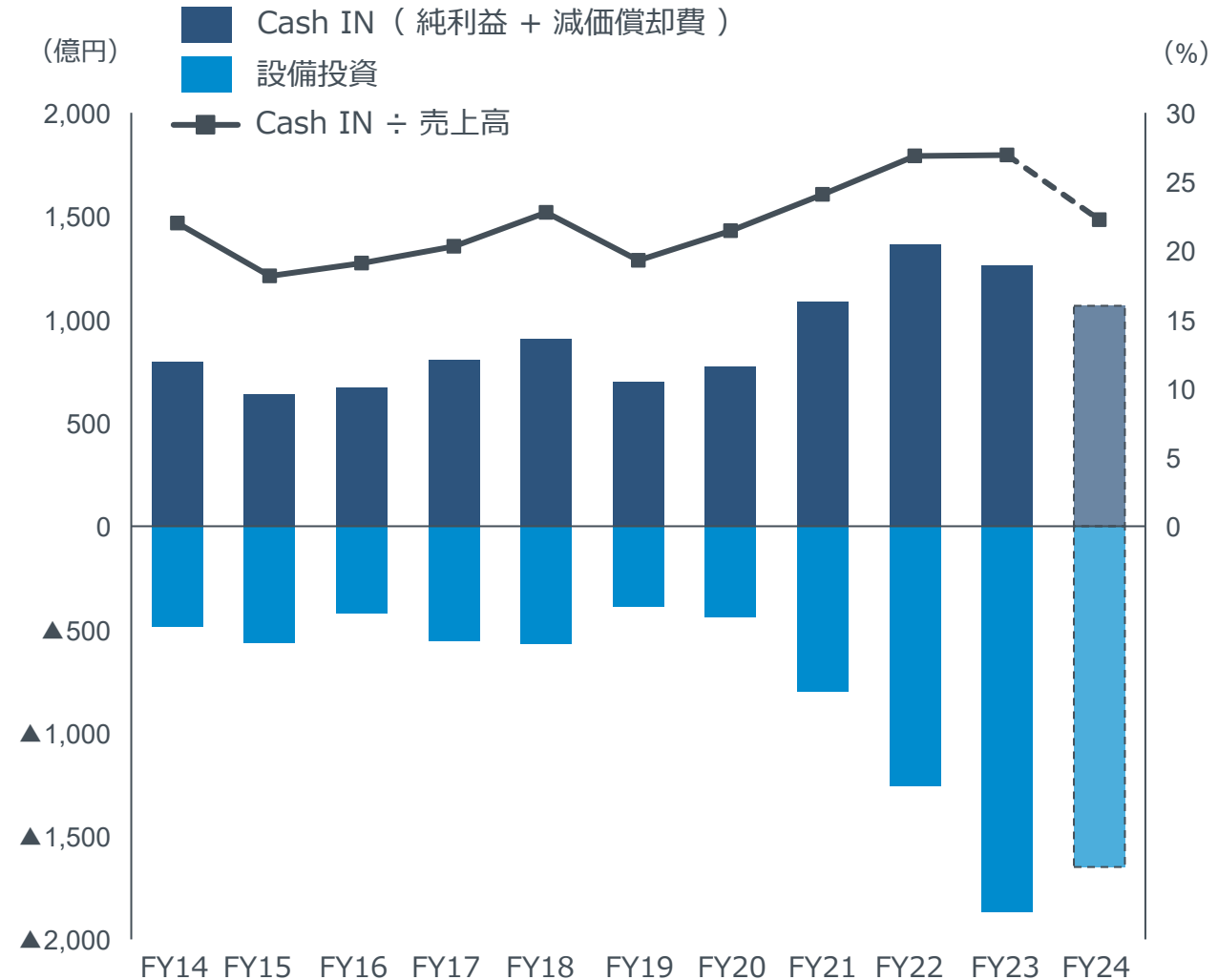
品質満足度スコア+10%改善 (2020年度比)

売上

中期経営計画
MOVING FORWARD
to 2025



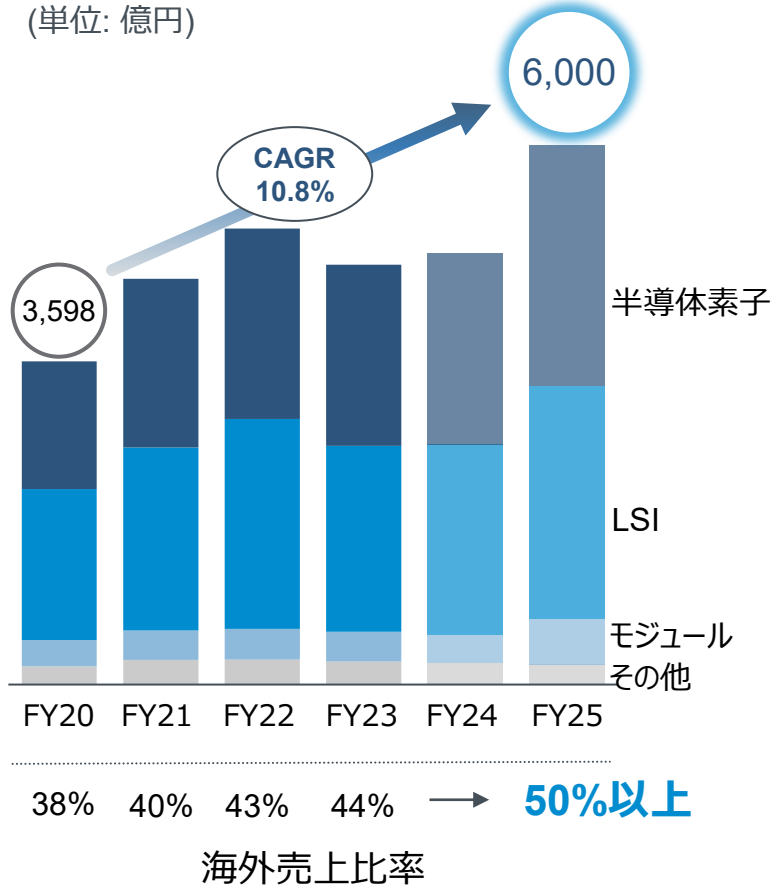
資金収支



パワーとアナログで車載と海外を中心に大きく伸ばす (方針変更なし)

中期経営計画の売上計画

(単位: 億円)



各事業の成長方針

- 伸ばす** 成長の核となる事業で売上を大きく伸ばす
- 進化する** 高付加価値化や海外シフト等質的変換を図る
- 創る** 2025年度以降の成長の種を新たに仕込む

		車載	産機	民生
半導体素子	パワーデバイス	<ul style="list-style-type: none"> SiC-MOS第4世代シェア拡大 Si-MOS第6世代 5G/6Gサーバー・基地局参入 		<ul style="list-style-type: none"> 省エネ家電向け高効率商品を拡大、海外展開加速 IGBT FRD Si-MOS
	小信号デバイス			
LSI		<ul style="list-style-type: none"> EV主機インバータ向けSiCパワーモジュール開発 電動車主機インバータ向けIGBTデバイス開発 	<ul style="list-style-type: none"> 小型化による高付加価値化とキャッシュカウ事業としてトップシェアの維持 需要変動に対応できる生産体制構築 	
LSI		<ul style="list-style-type: none"> 電動車向け商品強化 海外車載参入拡大 絶縁ゲートドライバ 電源LSI (PMIC) LEDドライバ 	<ul style="list-style-type: none"> 基地局/データセンター向け新商品開発 	<ul style="list-style-type: none"> 小型化・高効率商品で民生売上を維持 省エネ家電向け IPM、ACDC
モジュール その他				<ul style="list-style-type: none"> 自動運転支援モジュールやセキュリティ(認証)向けのセンシングデバイスに注力

「環境ビジョン2050」の達成に向け、年度目標を着実に実行 再生可能エネルギーの積極導入など環境負荷軽減への取り組みを加速



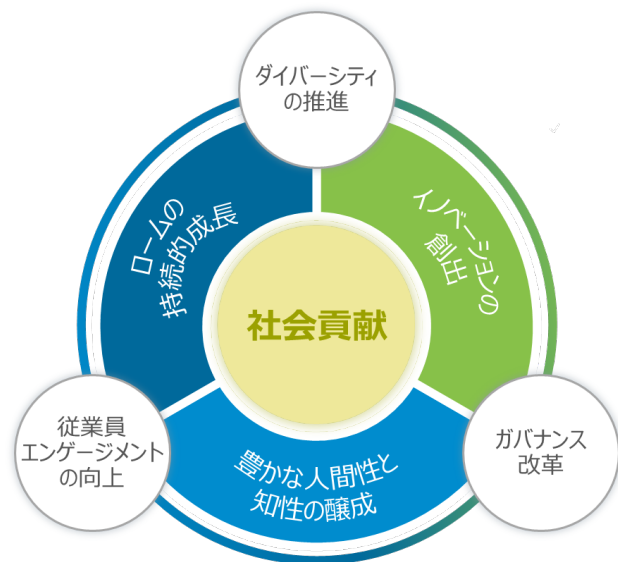
- RE100加盟
- TCFDフレームワークに基づく開示
- 行政との連携協定



SDGs重要課題（マテリアリティ）

	項目	2030年度へ向けた目標	2023年度
 気候変動 温室効果ガス排出量 実質ゼロ	温室効果ガス削減	排出量を2030年度に 2018年度比50.5%削減 排出量原単位を2030年度に2018年度比45%削減	○
	再生可能エネルギーの導入促進	2050年度に導入比率100%を目指し、再生可能エネルギー化を推進	○
 資源循環 ゼロエミッション	資源の削減	水の回収・再利用率を 2030年度に2019年度比5.5%以上向上	○
	廃棄物量の削減	2030年度に廃棄物のゼロエミッション化	○
 自然共生 自然サイクルと 事業活動の調和	緑化の促進	各拠点において工場緑化を促進 地域ごとに生息している生物の保全状況を改善	○
	化学物質管理の徹底	化学物質に関する世界各国の政策・規制への対応・管理の徹底、化学物質の使用量削減	○

豊かな人間性と知性を磨いた多様な社員が、高いエンゲージメントを維持し、継続的にイノベーションを創出
実効性のあるガバナンス改革と併せ、企業の持続的な成長を実現



■ 従業員エンゲージメントの向上

- エンゲージメントサーベイの実施
- 組織風土改革、働き方改革推進

2025年度目標

- エンゲージメントスコアで下記を達成
- 毎年のスコア改善
 - 業界平均以上
 - グループ全体で導入完了

2023年度結果

- 業界平均以上達成
- グループ全体で導入完了

■ ダイバーシティの推進

- 女性のキャリア形成促進
- 女性、外国人のマネジメント層への登用

2025年度目標

- グローバル女性管理職比率15%
- 女性または外国人の本社役員比率10%

2023年度結果

- グローバル女性管理職比率
12.6% → **13%**
- 女性または外国人の本社役員比率
23%
女性取締役比率 15% + 外国人取締役比率 8%

■ ガバナンス改革

- 独立社外取締役の比率の更なる引き上げ
- 中期経営計画に連動した報酬制度導入

2023年度結果

- 独立社外取締役比率**54%**
- 報酬構成や取締役の当社株式保有に対するあり方について協議を継続

2024年度 再生可能エネルギー 導入拠点



SiCrystal
(ドイツ)



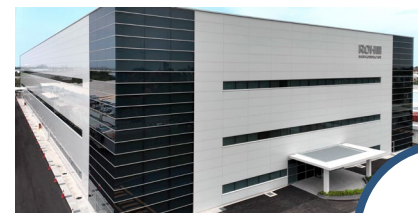
ローム・アポロ
(福岡・筑後)



RIST
(タイ)



REPI
(フィリピン)

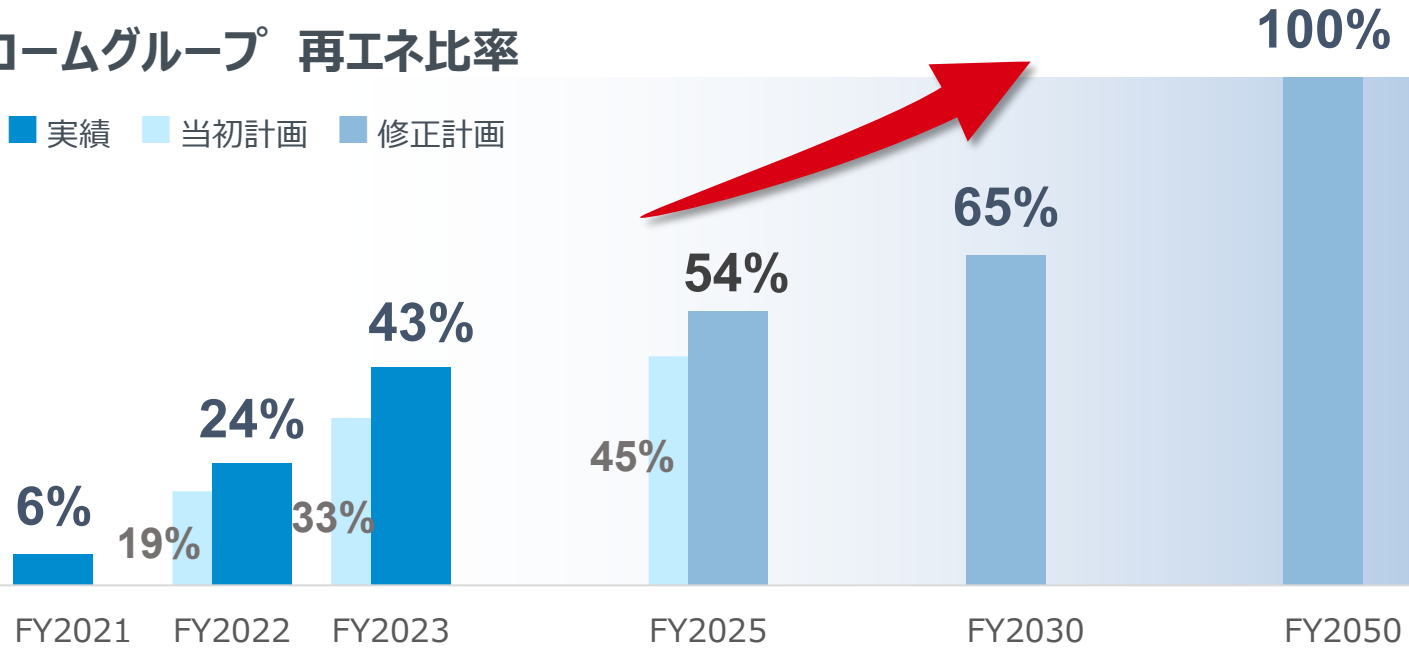


REMA
(マレーシア)



ロームグループ 再エネ比率

■実績 ■当初計画 ■修正計画



2050年度
100%に向け
計画を前倒しで進行中

サステナビリティに関する社外からの評価



半導体・半導体製造装置業界における上位15%の企業として
S&P Global社「Sustainability Yearbook Member」に
今年度初選定



ROHM Co., Ltd
Semiconductors & Semiconductor Equipment

**Sustainability
Yearbook Member**

S&P Global Corporate Sustainability
Assessment (CSA) Score 2023

S&P Global CSA Score 2023: 66/100
Score date: February 7, 2024
The S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA) Score is the S&P
Global ESG Score without the inclusion of any modelling approaches.
Position and scores are industry specific and reflect exclusion screening criteria.
Learn more at <https://www.spglobal.com/esg/csa/yearbook/methodology/>

S&P Global Sustainable1



CDP「水セキュリティ調査」において、
最高評価「リスト」に選定
「気候変動」ではA-に選定



EcoVadis社「サステナビリティ評価」で
ゴールドに格付け



「MSCI ESGレーティング」にてAA評価を取得

MSCI
ESG RATINGS

AA

CCC B BB BBB A AA AAA



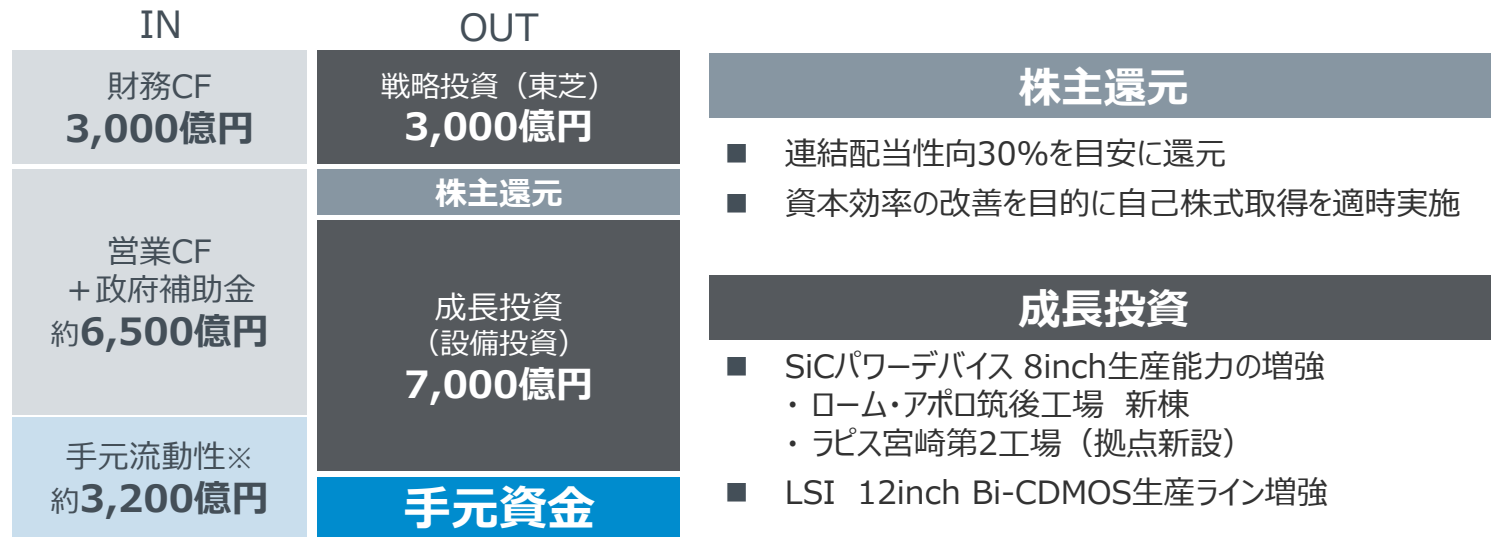
「FTSE4Good Index Series」
「FTSE Blossom Japan」
「FTSE Blossom Japan Sector
Relative Index」
構成銘柄に継続選定



財務方針（中計FY21～FY25累計）

- 市況悪化による営業CF減を政府補助金により補填し、成長投資6,000億円を**7,000億円**へ増額
- 3,000億円の資金調達により東芝非公開へ参画。半導体事業における連携強化により企業価値向上を図る
- 転換社債型新株予約権付社債（CB）を発行し、東芝非公開化への参画に際して借り入れたブリッジローンの返済資金の一部に充当
- ブリッジローン残債と'24/12に満期を迎えるCBの額面償還は**手元資金または負債性調達**（銀行借入、社債）で充当
- 株主還元方針は変更なし
- 手元資金の活用を加速、当初計画 年間売上の1/2以下を**1/3以下へ修正**

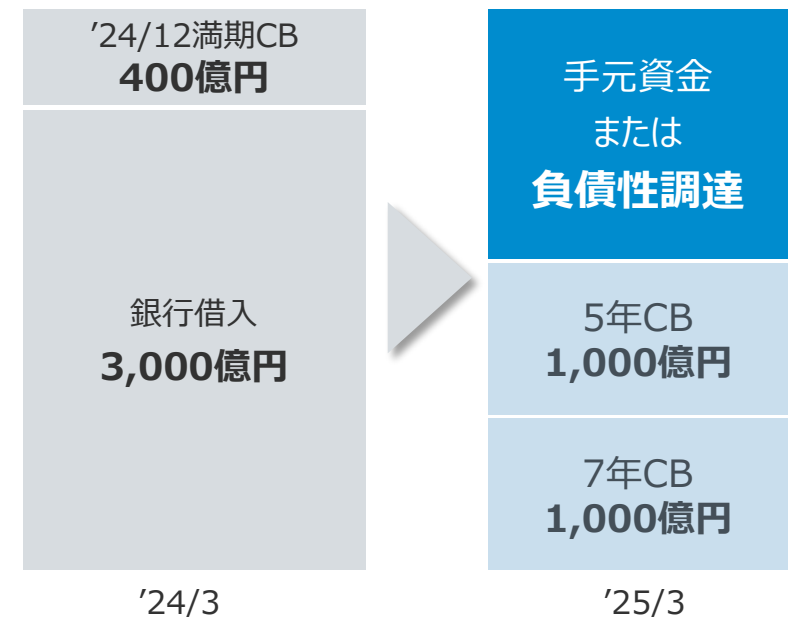
キャッシュアロケーション（中計FY21～FY25 5年累計）



※FY20 期末時点

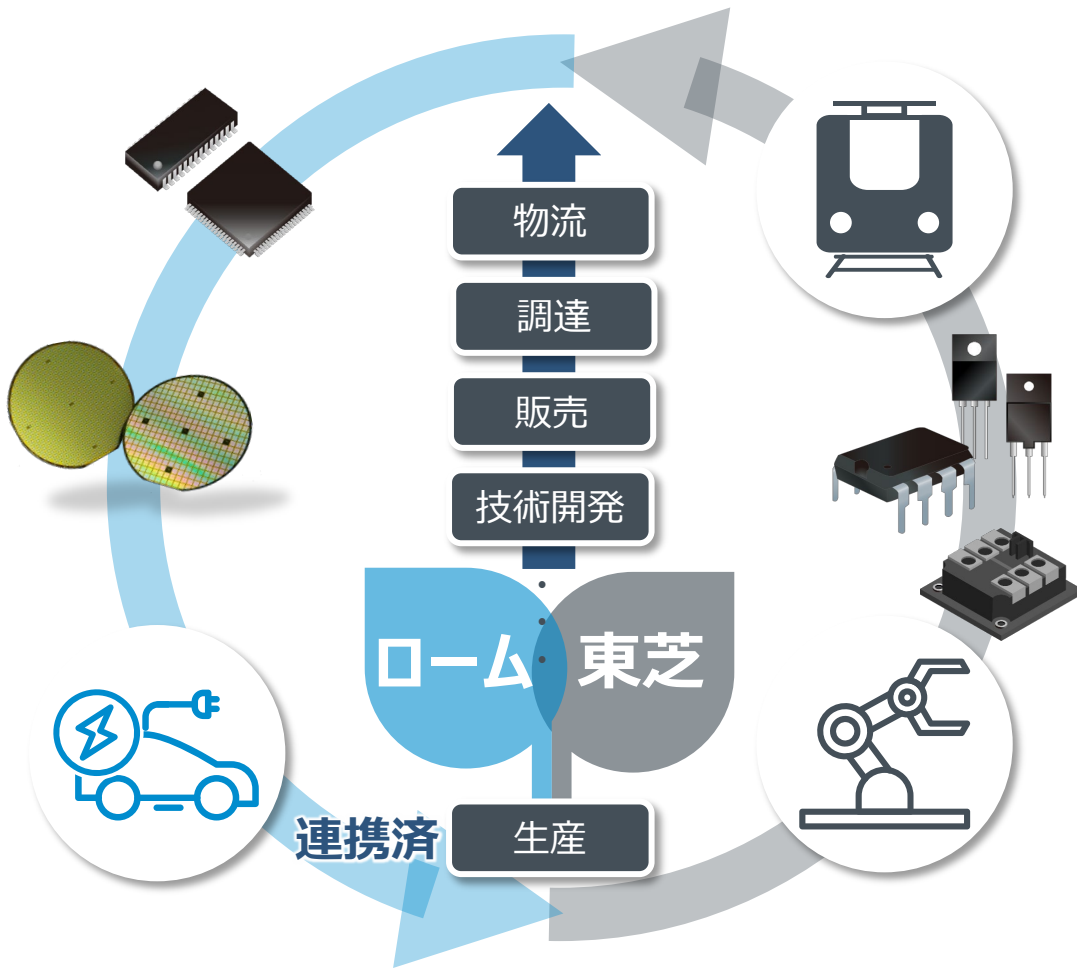
年間売上の1/3以下

負債に対するファイナンス方針



東芝の半導体事業は、ロームとの親和性が高く、様々なシナジーを創出できる可能性があり、業務提携強化に向けた協議開始の提案を実施 [3月29日公表]

ローム及び東芝双方の企業価値向上を目指す



提案の概要

東芝D&S半導体事業部を中心とした半導体事業に関して、技術開発、生産、販売、調達、物流など、あらゆる事業活動で連携を強化し、両社の企業価値向上を目指すもの。

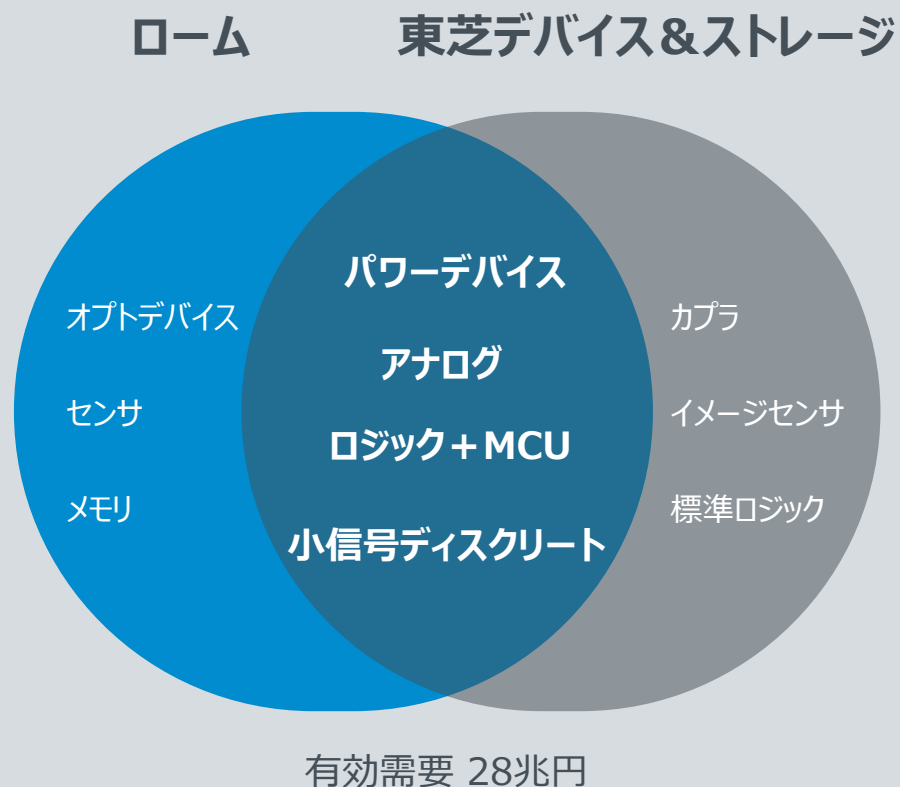
パワー半導体におけるプレゼンスの向上

技術力の強化

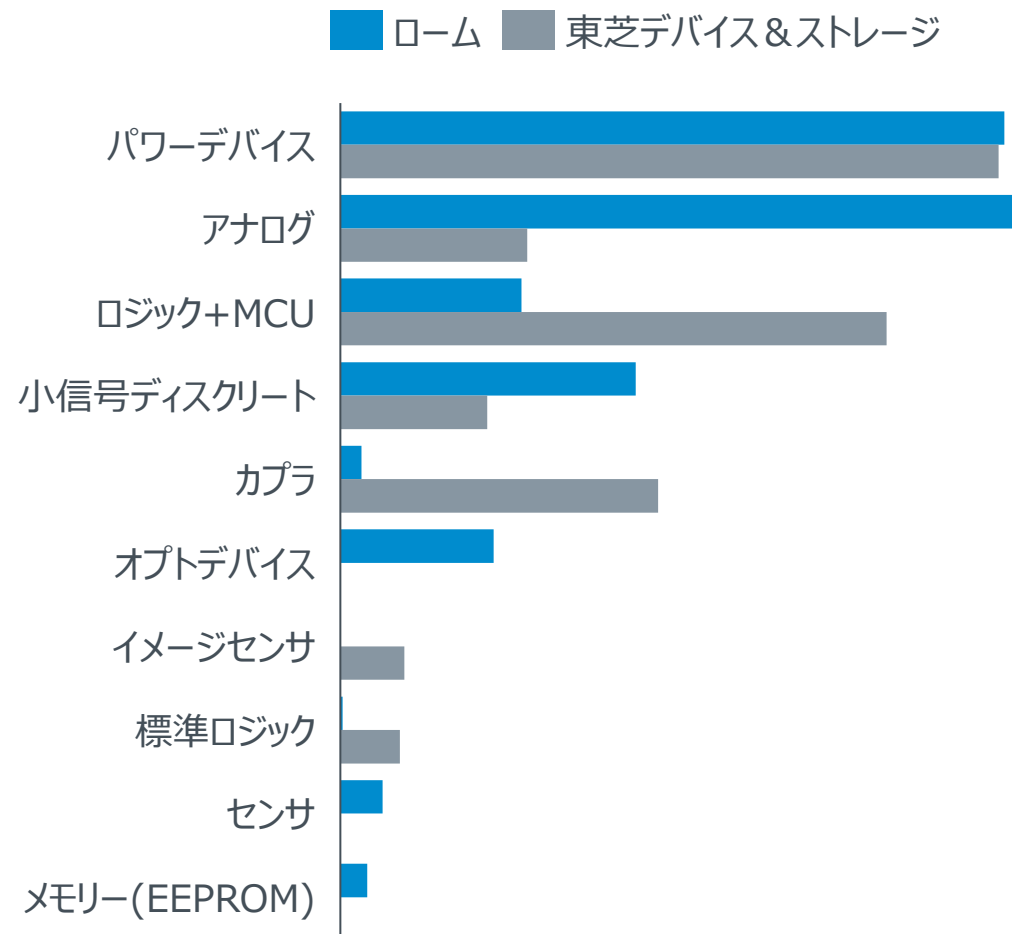
供給力の拡大

6月より業務提携に向けた協議を開始予定

事業領域、また注力製品カテゴリーが近く 親和性が高い



売上高 (2023年)





<ご注意事項>

1. 当資料は投資分析を目的として作成しておりますので、投資分析にのみご使用ください。
2. 2024年度通期の予想は、現時点で得られた情報にもとづいております。従って、業況の変化などにより記載の予想と大きく異なる場合があります。

<お問い合わせ先>

ローム株式会社 IR室
〒615-8585 京都市右京区西院溝崎町21
E-mail : ir@rohm.co.jp



Electronics for the Future

【参考】 転換社債型新株予約権付社債(CB)の発行の目的と背景

本資金調達目的

東芝非公開化への参画に際して借入れた
3,000億円のブリッジローンの返済資金の一部に充当

CBを選択した理由

銀行借入・SB・CBなど負債性資金調達の選択肢を幅広く検討し、
当社の信用力及び株価の特性を活かし、現在の市場環境下で良好
な条件が出せるCBを選択

キャッシュ・ベースでの金利コストが生じず、
資金調達コストの最小化を図った調達手段

転換制限条項を付与することで株価が転換価格を超えた場合でも
新株予約権が行使される可能性を相当程度抑制可能

額面現金決済型取得条項を付与することで、満期直前には、財務
状況を鑑みて、当社の選択により額面部分を現金にて償還することが
可能であり、将来の株式交付に伴う希薄化を大幅に回避可能。これ
により、株式交付による1株あたりの当期純利益(EPS)及びROEに対
する影響を大幅に緩和できる負債性の高い設計

CB活用により柔軟性の高い間接金融のキャパシティを温存
将来、資金需要を伴う戦略的アクションを機動的に実行可能

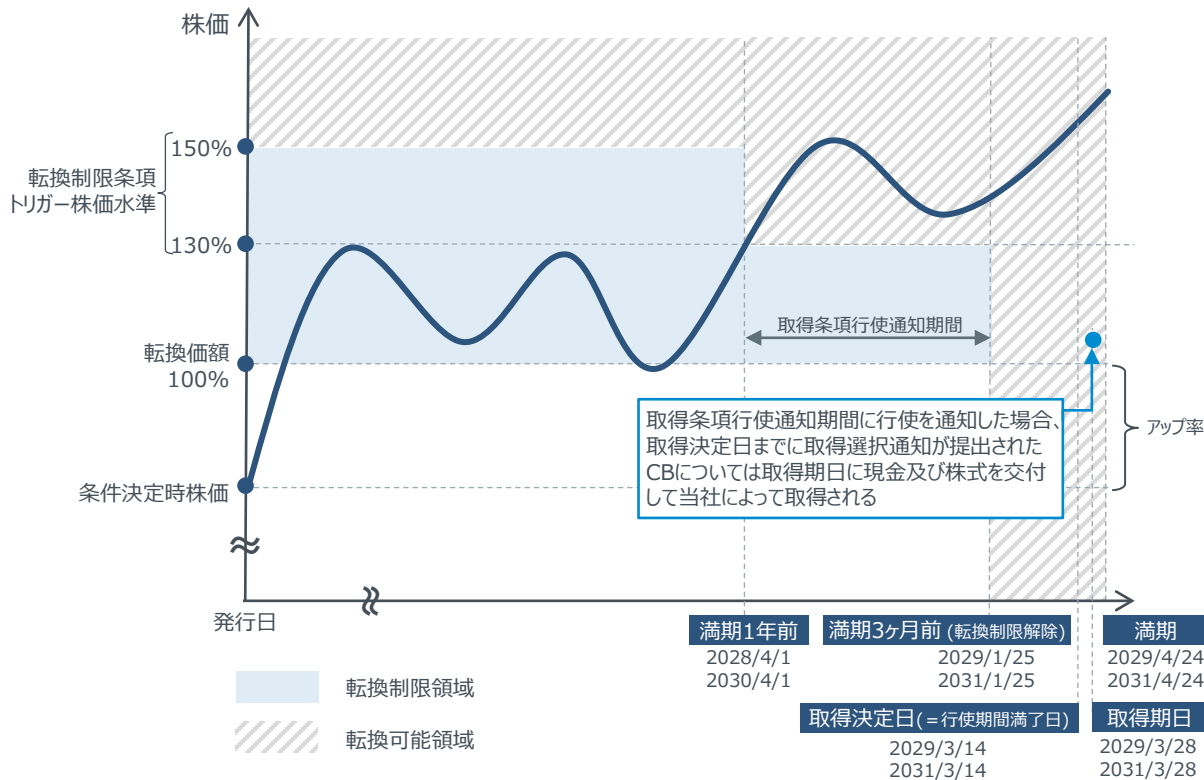
発行条件

発行形態	ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債	
募集市場	欧州及びアジアを中心とする海外市場 (但し、米国及びカナダを除く)	
条件決定日/発行日	2024年4月8日 / 2024年4月24日	
条件決定日の終値	2431.5円	
年限	5年	7年
発行金額	1,000億円	1,000億円
利率(クーポン)	0%	
付帯条項	①転換制限条項 ②額面現金決済型取得条項	
転換価額 (条件決定日の終値か らのアップ率)	3,063円 (25.97%)	2,943円 (21.04%)

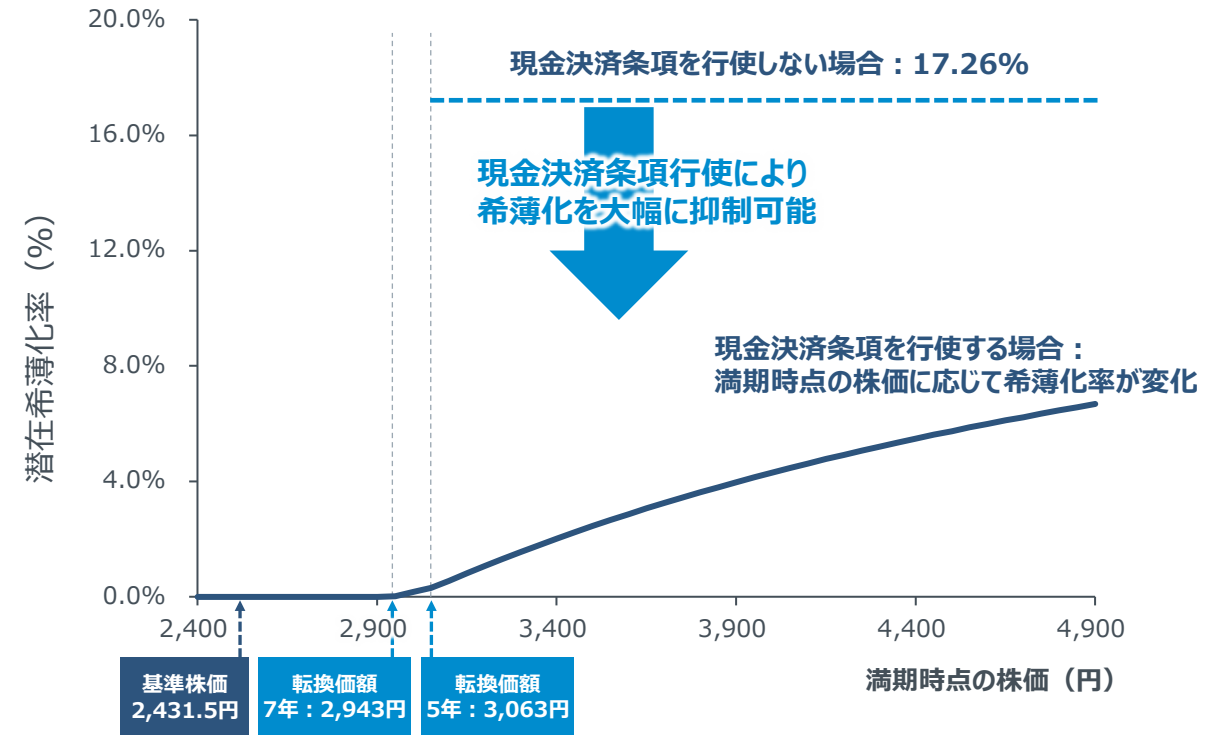
【参考】CBの商品設計について

- **転換制限条項**の付与により、期中の株価が転換価額の150%(~満期約1年前)または130%(満期約1年前~満期3か月前)を一定期間超えて推移しない限り、CB投資家が転換請求することのできない、**負債性の高いスキーム**を採用
- 社債額面金額相当額について、現金交付可能な**取得条項**を付与することで、当社の選択により**将来の希薄化を相当程度抑制**できる

CBの商品設計のイメージ¹



取得条項(額面現金決済型)行使時の希薄化抑制イメージ²



1. 株価変動はイメージであり、当社の株価の動きを予測又は保証するものではありません。また、新株予約権の行使可能期間の末日は2029/4/10と2031/4/10とされていますが、当社が取得条項を行使した場合、本新株予約権付社債権者にとっては転換制限解除日の前日が取得条項が行使された場合の実質的な行使期間満了日となります。

2. 取得条項に係る希薄化率については発行当初の数値であり、今後転換価額が調整される場合にはその調整に伴って希薄化率も変化いたします。また、潜在希薄化率の算出に当たっては、転換制限条項が期中に一度も解除されなかったことを前提としております。なお、記載のグラフは5年満期、7年満期の両トランシェの合算値を想定しております。